

半导体

证券研究报告
2024年02月27日

英伟达业绩超预期，HBM 需求旺盛，华为 P70 值得期待

投资评级
行业评级 强于大市(维持评级)
上次评级 强于大市

一周行情概览：上周半导体行情优于大部分主要指数。上周创业板指数上涨 1.81%，上证综指上涨 4.85%，深证综指上涨 2.82%，中小板指上涨 2.60%，万得全 A 上涨 5.18%，申万半导体行业指数上涨 5.09%，半导体行业指数行情优于除万得全 A 以外其他主要指数。**半导体各细分板块涨幅明显，其他板块领涨，半导体制造涨幅最低。**半导体细分板块中，IC 设计板块上周上涨 4.9%，半导体材料板块上周上涨 5.8%，分立器件板块上周上涨 2.2%，半导体设备板块上周上涨 4.8%，封测板块上周上涨 3.6%，半导体制造板块上周上涨 1.3%。

作者
潘暕 分析师
SAC 执业证书编号：S1110517070005
panjian@tfzq.com
骆奕扬 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521050001
luoyiyang@tfzq.com
程如莹 分析师
SAC 执业证书编号：S1110521110002
chengruying@tfzq.com

行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。创新方面，人工智能/卫星通讯/MR 将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。Stability AI 发布文生图模型 Stable Diffusion 3，生成式 AI 持续迭代，算力需求持续增长。OpenAI 发布文生视频 Sora 模型后，上周 Stability AI 发布文生图模型 Stable Diffusion 3 系列，参数量从 800M 到 8B 不等，和 Sora 一样，模型采用了 diffusion transformer 架构。随着生成式 AI 持续迭代，未来在生活中被广泛应用，以英伟达为首的算力产业链有望量价齐升，进而带动先进制程扩产，相关机会值得关注。



资料来源：聚源数据

英伟达 FY4Q24 超预期，FY1Q25 指引强劲，算力产业链景气度得到验证。英伟达于 2 月 21 日发布 FY4Q24 业绩(财季截止于 2024 年 1 月 28 日)，营收 221 亿美元，YoY+265%，QoQ+22%，历史新高；数据中心业务营收本季度同比大幅增长 409%，达到 184 亿美元(其中 40%为 AI 相关需求)，主要受到生成式 AI 和 LLM 需求带动，Hopper GPU 和 InfiniBand 交换机芯片出货量大幅增长，公司认为目前 Hopper 的需求仍十分旺盛，预计下一代产品将供不应求。FY1Q25 指引强劲，公司预计营收 240 亿美元(±2%)，体现了 AI 产业大趋势下算力需求持续旺盛，验证了算力产业链较高的景气度，生成式 AI 持续推动算力需求增长，持续看好算力产业链。

相关报告
1 《半导体-行业研究周报:中芯华虹将发布 4Q23 业绩，看好晶圆代工周期复苏》 2024-02-06
2 《半导体-行业研究周报:三星 S24 海外预定量超预期，AI 有望拉动半导体复苏》 2024-01-29
3 《半导体-行业研究周报:台积电 24 年指引乐观，三星 AI 手机值得期待》 2024-01-22

HBM 需求旺盛，海力士美光 2024 年生产配合售罄，看好 HBM 材料的机遇。SK 海力士副总裁 Kim Ki-tae 表示 2024 年海力士旗下 HBM 产能已售罄，此前美光在业绩会中也表示得益于生成式 AI 需求增长，美光 2024 年的 HBM 产能预计已全部售罄。我们预计 2024 年或将是 HBM 扩产大年，HBM 及先进封装材料的需求有望持续增长，产业链机遇值得关注。

华为本周发布 Pocket 2 小折叠机，P70 预计发售在即，华为手机产业链景气度较高。华为于 2 月 22 日发布 Pocket 2 小折叠机，售价 7499 元起，支持双向北斗卫星消息，为上下折叠领域的首款支持卫星通讯的手机，P70 系列预计发售在即(P60 于 23 年 3 月末发布)。2023 年 Mate60 系列发售以来，华为手机销量持续亮眼，Counter Point 数据显示，2024 年前两周，华为手机在中国市场的销量份额重回第一，华为手机产业链预计随着华为手机出货量提升，将有望体现出营收业绩双增。

建议关注：

- 1) 半导体设计：汇顶科技/晶晨股份/瑞芯微/全志科技/恒玄科技/乐鑫科技/寒武纪/龙芯中科/海光信息(天风计算机覆盖)/江波龙(天风计算机联合覆盖)/北京君正/富瀚微/普冉股份/东芯股份/澜起科技/聚辰股份/帝奥微/纳芯微/圣邦股份/中颖电子/斯达半导/宏微科技/东微半导/思瑞浦/扬杰科技/新洁能/兆易创新/韦尔股份/思特威/艾为电子/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/复旦微电/希荻微
- 2) 半导体材料设备零部件：艾森股份/正帆科技(天风机械联合覆盖)/江丰电子/北方华创/新莱应材(天风机械覆盖)/华亚智能/英杰电气(天风电新覆盖)/富创精密/明志科技/汉钟精机(天风机械覆盖)；雅克科技/沪硅产业/华峰测控(天风机械覆盖)/上海新阳/中微公司/精测电子(天风机械联合覆盖)/长川科技(天风机械覆盖)/鼎龙股份(天风化工联合覆盖)/安集科技/拓荆科技(天风机械联合覆盖)/盛美上海/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/金宏气体(天风化工覆盖)/凯美特气/和远气体(天风化工联合覆盖)
- 3) IDM 代工封测：时代电气/士兰微/扬杰科技/闻泰科技/三安光电；华虹公司/中芯国际/长电科技/通富微电
- 4) 卫星产业链：电科芯片/华力创通/复旦微电/北斗星通/利扬芯片

风险提示：地缘政治带来的不可预测风险，需求复苏不及预期，技术迭代不及预期

内容目录

1. 本周观点 (24.02.19-24.02.23): 英伟达业绩超预期, HBM 需求旺盛, 华为 P70 值得期待	3
2. 本周 (24.02.19-24.02.23) 重要事件及行情更新	5
3. 半导体产业宏观数据: 半导体销售恢复中高速增长, 存储成关键	7
4. 芯片交期及库存: 全球芯片交期持续改善, 需求复苏下行业重回上升周期	9
5. 产业链各环节景气度:	14
5.1. 设计: 库存去化效益显现, 需求复苏有望带动基本面持续向好	14
5.1.1. 存储: 周期已触底反弹, NAND 价格短期内或再涨 50%	14
5.1.2. 数字芯片: 高通发布 MR 设备芯片 XR2+Gen 2, 重点关注 XR 市场相关标的	20
5.1.3. 模拟芯片: 传 ADI 上调价格, 涨价有望潮蔓延至模拟芯片	22
5.1.4. 功率器件: 受地震影响部分日本功率半导体工厂停产, 部分品类行情或有波动	24
5.1.5. 射频芯片: 手机射频相关需求景气度回暖	26
5.1.6. CIS: 消费电子景气回暖及补库拉动业绩回升, 三星 CIS 24 年有望开启涨价	26
5.2. 代工: 先进制程需求增长, 台积电计划 2024 年底 3nm 产能提升至 80%	26
5.3. 封测: 先进封装需求供不应求, 行业复苏趋势明显	28
5.4. 设备材料零部件: 1 月, 可统计设备中标数量 27 台, 招标数量 27 台	29
5.4.1. 设备及零部件中标情况: 1 月可统计设备中标数量同比出现下滑	29
5.4.2. 设备招标情况: 1 月可统计设备招标数量 27 台, 同比-46%	33
5.5. 分销商: 整体分销市场需求逐步回升, 2024 年行业复苏可期	34
6. 终端应用: 看好消费电子复苏, 关注元宇宙发展走势	34
6.1. 消费电子: 1 月 AI 成 PC 市场新增长点, 关注苹果 MR 新品对供应链影响	34
6.2. 新能源汽车: 强者恒强, 行业进入加速洗牌期	35
6.3. 工控: 工控行业订单低迷, 国产品牌市占率提升	36
6.4. 光伏: 光伏行业市场供大于求, 库存去化仍在持续	36
6.5. 储能: 行业库存问题仍存在, 终端需求维持乐观预期	36
6.6. 服务器: AI 服务器及上游核心芯片需求维持稳定, 看好 2024 年市场增长	36
6.7. 通信: 通信相关需求低迷, 预计今年市场需求进一步下滑	37
7. 本周海外半导体行情回顾	37
8. 本周 (02/19-02/23) 半导体行情回顾	38
9. 本周 (02/19-02/23) 重点公司公告	39
10. 本周 (02/19-02/23) 半导体重点新闻	42

1. 本周观点 (24.02.19-24.02.23): 英伟达业绩超预期, HBM 需求旺盛, 华为 P70 值得期待

行业周期当前处于相对底部区间, 我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度, 优先复苏的品种财务报表有望优先改善, 长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位, 经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。创新方面, 人工智能/卫星通讯/MR 将是较大的产业趋势, 产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。

Stability AI 发布文生图模型 Stable Diffusion 3, 生成式 AI 持续迭代, 算力需求持续增长。 OpenAI 发布文生视频 Sora 模型后, 上周 Stability AI 发布文生图模型 Stable Diffusion 3 系列, 参数量从 800M 到 8B 不等, 和 Sora 一样, 模型采用了 diffusion transformer 架构 (此前为扩散架构)。随着生成式 AI 持续迭代, 未来在生活中被广泛应用, 以英伟达为首的算力产业链有望量价齐升, 进而带动先进制程扩产, 相关机会值得关注。

英伟达 FY4Q24 超预期, FY1Q25 指引强劲, 算力产业链景气度得到验证。 英伟达于 2 月 21 日发布 FY4Q24 业绩 (财季截止于 2024 年 1 月 28 日), 营收 221 亿美元, YoY+265%, QoQ+22%, 历史新高; 数据中心业务营收本季度同比大幅增长 409%, 达到 184 亿美元 (其中 40% 为 AI 相关需求), 主要受到生成式 AI 和 LLM 需求带动, Hopper GPU 和 InfiniBand 交换机芯片出货量大幅增长, 公司认为目前 Hopper 的需求仍十分旺盛, 预计下一代产品将供不应求。FY1Q25 指引强劲, 公司预计营收 240 亿美元 ($\pm 2%$), 体现了 AI 产业大趋势下算力需求持续旺盛, 验证了算力产业链较高的景气度, 生成式 AI 持续推动算力需求增长, 持续看好算力产业链。

HBM 需求旺盛, 海力士美光 2024 年生产配合售罄, 看好 HBM 材料的机遇。 SK 海力士副总裁 Kim Ki-tae 表示 2024 年海力士旗下 HBM 产能已售罄, 此前美光在业绩会中也表示得益于生成式 AI 需求增长, 美光 2024 年的 HBM 产能预计已全部售罄。我们预计 2024 年或将是 HBM 扩产大年, HBM 及先进封装材料的需求有望持续增长, 产业链机遇值得关注。

华为本周发布 Pocket 2 小折叠机, P70 预计发售在即, 华为手机产业链景气度较高。 华为于 2 月 22 日发布 Pocket 2 小折叠机, 售价 7499 元起, 支持双向北斗卫星消息, 为上下折叠领域的首款支持卫星通讯的手机, P70 系列预计发售在即 (P60 于 23 年 3 月末发布)。2023 年 Mate60 系列发售以来, 华为手机销量持续亮眼, Counter Point 数据显示, 2024 年前两周, 华为手机在中国市场的销量份额重回第一, 华为手机产业链预计随着华为手机出货量提升, 将有望体现出营收业绩双增。

图 1: 海外半导体公司业绩跟踪

海外市场半导体公司业绩跟踪 2024																	
公司名称	财报发布日期		货币	收入				yoy			Non-GAAP利润			Non-GAAP利润率			变化
	上期	本期		上季	本期预期	下季	上季	本期预期	下季	上季	本期预期	下季	上季	本期预期	下季		
封装																	
日月光ASE	2024/2/1	2024/4/29	TWD	160,581	in line	132,527	143,906	5%	3%	6%	9,392	beat	6,144	8,602	5.8%	4.6%	6.0%
安森美Ankor	2024/2/5	2024/5/1	USD	1,752	beat	1,365	1,408	1%	2%	4%	118	beat	29	43	6.7%	2.1%	3.0%
力成科技	2024/1/30	2024/4/25	TWD	19,034	beat	17,526	19,051	4%	3%	6%	3,965	beat	1,320	1,663	20.8%	7.5%	8.7%
京元电子	2024/2/23	2024/5/6	TWD	8,500	miss	8,170	9,016	-8%	2%	3%	1,578	beat	1,336	1,671	18.6%	16.3%	18.5%
制造																	
中芯国际	2024/2/6	2024/5/13	USD	1,678	beat	1,691	1,708	3.5%	15.6%	9.4%	174	beat	86	116	10.4%	5.1%	6.8%
华虹半导体	2024/2/6	2024/5/13	USD	455	miss	476	509	-26.6%	-24.3%	-19.4%	35	beat	-13	5	7.8%	-2.7%	1.0%
台积电	2024/1/18	2024/4/22	TWD	625,529	beat	577,939	615,828	0.0%	13.6%	28.1%	238,712	beat	212,346	228,072	38.2%	36.7%	37.0%
联电	2024/1/31	2024/4/24	TWD	54,958	in line	53,448	55,991	-19.0%	-1.4%	-0.5%	13,195	beat	10,630	11,652	24.0%	19.9%	20.8%
格罗方德	2024/2/13	2024/5/9	USD	1,854	in line	1,521	1,576	-11.8%	-17.4%	-14.6%	306	miss	129	143	16.5%	8.5%	9.0%
三星	2024/1/31	2024/4/8	KRW	47,778,938	in line	39,871,342	70,184,281	-3.8%	11.2%	17.0%	5,290,751	miss	4,582,871	5,690,188	7.8%	6.5%	8.1%
Towerjazz	2024/2/14	2024/5/15	USD	352	miss	325	337	-12.8%	-8.7%	-5.7%	-194	beat	45	48	-55.1%	13.9%	14.2%
东部高科	2024/2/5	2024/5/13	KRW	283,405	in line	257,000	235,000	-28.7%	-18.8%	-23.0%	35,643	miss	41,000	26,500	12.6%	-	16.0%
世界	2024/2/2	2024/5/3	TWD	9,674	miss	9,219	9,842	1.1%	12.6%	-0.1%	2,388	miss	1,001	1,269	24.7%	10.9%	12.9%
GPU/GPU																	
英特尔	2024/1/25	2024/4/26	USD	15,406	in line	12,797	13,644	9.7%	9.2%	5.4%	1,734	in line	563	1,045	11.3%	4.4%	7.7%
英伟达	2024/2/21	2024/5/24	USD	22,103	beat	24,018	25,891	265.3%	234.0%	91.7%	12,210	miss	13,486	14,277	55.2%	56.1%	55.1%
AMD	2024/1/30	2024/5/2	USD	6,168	beat	5,444	5,700	10.2%	1.7%	0.4%	697	beat	982	1,114	11.3%	18.0%	19.5%
存储																	
美光	2023/12/2	2024/3/20	USD	4,726	in line	5,321	5,921	15.7%	44.1%	57.8%	-1,184	in line	-324	176	-25.1%	-6.1%	3.0%
西部数据	2024/1/24	2024/5/8	USD	3,032	beat	3,304	3,602	-2.4%	17.9%	34.8%	-258	miss	21	230	-8.5%	0.6%	6.4%
旺宏	2023/10/2	2024/4/25	TWD	7,283	beat	6,528	6,062	-36.5%	-28.1%	-14.7%	-408	beat	-656	-783	-5.6%	-10.0%	-12.9%
希捷	2024/1/24	2024/4/19	USD	1,555	miss	1,666	1,827	-17.6%	-10.4%	14.1%	-4	miss	55	124	-0.2%	3.3%	6.8%
南亚科技	2024/1/10	2024/4/11	TWD	8,704	in line	9,872	11,519	9.4%	53.7%	63.9%	-2,405	beat	-1,436	-212	-27.6%	-14.5%	-1.8%
东芝	2023/11/1	#N/A	JPY	793,545	in line	-	-	-7.1%	-	-	-24,801	miss	-	-	-3.1%	-	-
SK Hynix	2024/1/25	2024/4/26	KRW	11,305,505	in line	11,548,184	13,429,977	47.4%	127.0%	83.8%	-1,357,105	beat	599,075	1,543,896	-12.0%	4.8%	11.5%
数据中心																	
赛灵思	2022/1/2	#N/A	USD	1,011	in line	1,026	1,046	2.8%	20.6%	18.0%	314	in line	293	293	31.1%	28.6%	28.0%
Lattice	2024/2/12	2024/5/1	USD	171	beat	140	141	-8.0%	-3.9%	-6.0%	45	beat	39	38	26.4%	28.1%	27.3%
迈威尔科技	2023/11/3	2024/3/7	USD	1,419	miss	1,419	1,366	-2.7%	0.1%	3.4%	-70	miss	405	359	-4.9%	28.5%	26.3%
博通	2023/12/7	2024/3/7	USD	9,295	beat	11,584	11,962	4.1%	29.9%	37.0%	3,613	miss	5,042	5,418	38.9%	43.5%	45.3%
Credo	2023/11/2	2024/2/7	USD	44	beat	52	60	-14.3%	-3.7%	85.9%	-7	beat	4	8	-15.0%	7.1%	12.6%
手机芯片																	
高通公司	2024/1/31	2024/5/3	USD	9,935	in line	9,327	9,055	5.0%	0.6%	7.1%	2,621	in line	2,604	2,409	26.4%	27.9%	26.6%
联发科	2024/1/31	2024/4/29	TWD	129,562	in line	123,603	127,794	19.7%	29.2%	30.2%	25,663	in line	22,027	22,549	19.8%	17.8%	17.6%
思佳讯解决方案	2024/1/30	2024/5/8	USD	1,202	beat	1,046	1,024	-9.6%	-9.3%	-4.4%	245	beat	245	236	20.4%	23.4%	23.1%
QORVO	2024/1/31	2024/5/3	USD	1,074	in line	926	919	44.5%	46.4%	41.2%	89	in line	118	123	8.3%	12.7%	13.4%
KNOWLES	2024/2/7	2024/4/26	USD	215	beat	195	205	9.2%	35.3%	18.2%	38	miss	17	21	17.9%	8.6%	10.4%
神盾	2023/11/8	2024/3/29	TWD	947	beat	-	-	19.0%	-	-	-224	beat	-	-	-23.7%	-	-
FPC	2024/2/8	2024/5/7	SEK	200	in line	-	-	5.3%	-	-	-127	miss	-9	-	-63.5%	-	-
模拟																	
德州仪器	2024/1/23	2024/4/25	USD	4,077	in line	3,610	3,774	-12.7%	-17.4%	-14.7%	1,362	beat	995	1,088	33.4%	27.6%	28.8%
ADI	2024/2/21	2024/5/24	USD	2,513	-	2,103	2,195	-12.7%	-3.6%	-2.8%	864	-	632	689	34.4%	30.0%	31.4%
恩智浦	2024/2/5	2024/4/29	USD	3,422	-	3,127	3,122	3.3%	0.2%	-5.4%	917	-	822	793	26.8%	26.3%	25.4%
意法半导体	2024/1/25	2024/4/26	USD	4,282	in line	3,609	3,790	-3.1%	-1.4%	-12.1%	1,076	in line	534	599	25.1%	14.8%	15.8%
微芯科技	2024/2/1	2024/5/3	USD	1,766	miss	1,330	1,340	-18.6%	-40.8%	-41.4%	421	in line	311	317	23.9%	23.4%	23.6%
MPWR	2024/2/7	2024/5/3	USD	454	in line	447	476	-1.3%	-0.8%	7.9%	97	in line	130	141	21.3%	29.1%	29.6%
分立器件																	
安森美	2024/2/5	2024/5/1	USD	2,018	in line	1,850	1,828	-4.1%	-5.4%	-12.7%	581	beat	451	433	28.8%	24.4%	23.7%
Navitas	2023/11/9	2024/2/29	USD	22	in line	-	-	114.6%	-	-	8	8	-14	-14	34.3%	-	-
英飞凌	2024/2/6	2024/5/7	EUR	3,702	in line	3,610	3,998	-5.3%	-12.4%	-2.2%	598	miss	501	670	16.2%	13.9%	16.7%
赛普拉斯	2020/1/30	#N/A	USD	560	in line	538	575	7.4%	40.2%	9%	42	in line	95	117	7.6%	17.7%	20.3%
设备																	
应用材料	2024/2/15	2024/5/16	USD	6,707	beat	6,521	6,593	0.5%	-1.6%	2.6%	1,797	beat	1,659	1,647	26.8%	25.4%	25.0%
拉姆研究	2024/1/24	2024/4/19	USD	3,758	miss	3,717	3,793	-2.8%	-8%	18.2%	991	miss	966	972	26.4%	26.0%	25.6%
科天半导体	2024/1/25	2024/4/26	USD	2,487	in line	2,303	2,450	-16.4%	-8.3%	4.4%	839	miss	715	781	33.7%	31.0%	31.9%
阿斯麦	2024/1/24	2024/4/17	EUR	7,237	in line	5,450	6,330	12.5%	-19.2%	-8.3%	2,337	in line	1,128	1,530	32.3%	20.7%	24.2%
泰瑞达	2024/1/30	2024/4/26	USD	671	beat	567	637	-8.4%	-8.2%	-6.9%	53	beat	98	123	17.3%	9.3%	15.4%
ASM Pacific	2023/10/2	2024/2/27	HKD	3,474	beat	3,311	3,497	-23.8%	-23.5%	-10.7%	47	beat	172	225	1.4%	5.2%	6.4%
盛美半导体	2023/11/7	2024/2/28	USD	169	beat	149	120	26.1%	37.6%	62.1%	26	beat	8	8	15.5%	5.5%	6.8%
EDA																	
CADENCE	2024/2/12	2024/4/24	USD	1,069	beat	1,001	1,104	18.8%	-2.1%	13.1%	298	beat	309	365	27.9%	30.9%	33.1%
Synopsys	2024/2/21	2024/5/17	USD	1,649	in line	1,575	1,648	21.1%	12.9%	10.8%	435	in line	485	512	26.4%	30.8%	31.1%
晶圆																	
日本信越	2024/1/26	2024/4/26	JPY	627,501	miss	600,082	652,800	-16.8%	-7.0%	8.9%	114,725	beat	144,190	128,900	18.3%	24.0%	19.7%
SUMCO	2024/2/14	2024/5/10	JPY	105,090	in line	97,333	103,400	-10.5%	-11.5%	-6.6%	5,195	in line	6,134	7,400	4.9%	6.3%	7.2%
Siltronic	2023/10/2	2024/3/12	EUR	349	in line	357	360	-26.4%	-24.4%	-11.1%	34	miss	25	-1	9.7%	6.9%	-0.3%
Global Wafer	2023/11/7	2024/3/6	TWD	17,376	in line	16,910	16,791	-3.7%	-8.0%	-9.8%	4,410	miss	3,817	3,795	25.4%	22.6%	22.6%
手机厂商																	
苹果	2024/2/1	2024/5/2	USD	119,575	in line	91,707	84,511	2.1%	-3.3%	3.3%	33,916	miss	23,632	20,479	28.4%	25.8%	24.2%
小米集团	2023/11/2	2024/3/25	CNY	70,894	beat	72,448											

2. 本周（24.02.19-24.02.23）重要事件及行情更新

行业头条：

- 1、2023 年我国集成电路产量 3514 亿块，同比增长 6.9%（工信部）；
- 2、2023 年中国车用激光雷达出货量达 71 万台，同比增长约 450%；
- 3、截至 2023 年底全国新能源汽车保有量 2041 万辆(公安部)；
- 4、2023Q4 全球 TWS 市场出货量同比增长 6.5%(Canalys)；
- 5、全球半导体市场在 2023 年 Q4 环比增长了 8.4%(WSTS)；
- 6、订单需求放缓，预计 Q1 MLCC 出货环比减少 7%(TrendForce)；
- 7、2024 年 Q1 全球服务器出货有望季增 1.7%淡季不淡(DIGITIMES)；
- 8、预计 2024 年第一季度 IC 销售额将强劲增长 18% (SEMI)；
- 9、1 月我国新能源汽车销量 72.9 万辆，同比增长 78.8%(中汽协)；

*资料来源：芯八哥公众号

厂商动态：

- 1、英伟达发布最新财年收入 609 亿美元，增长 126%；
- 2、英伟达市值逼近 2 万亿，一夜暴涨 2770 亿美元；
- 3、日本瑞萨电子宣布 59.1 亿美元收购 Altium；
- 4、微芯科技 Q3 业绩低于预期，客户需求持续降低；
- 5、晶晨股份 2023 年 Q4 净利润同比暴增 297.83%；
- 6、客户维持保守态度，世界先进 Q1 整体稼动率降至 50%；
- 7、晶旭半导体获亿元投资，助推年产 75 万片氧化镓外延片达产；
- 8、海外订单翻倍，现代摩比斯预计 2024 年再将强劲增长；
- 9、江波龙 LS500、LS600 系列主控芯片已完成流片验证并投产；
- 10、AMD MI300 芯片销售超预期，有望带动营收翻倍；
- 11、大众官宣与小鹏合作开发的新车型将在合肥投产；
- 12、Arm 预测 Q1 收入超预期，AI 芯片发展等推动股价飙升；
- 13、网络巨头思科据悉拟裁员数千人，专注于高增长领域；
- 14、英特尔多款 CPU 遭德禁售华硕、宏碁、广达、纬创等恐受波及；
- 15、Tower 半导体计划投资 80 亿美元在印度建芯片厂；
- 16、OpenAI 正寻求筹资多达 7 万亿美元，以重塑全球半导体产业；
- 17、SK 海力士与台积电合作开发第六代 HBM；
- 18、德国大陆集团将裁员超 7000 人；
- 19、韩国 1 月 ICT 出口额同比增 25%，半导体同比大增 53%；
- 20、比亚迪计划在墨西哥新建电动汽车工厂；

- 21、OpenAI 发布文本生成影像视频模型 Sora；
- 22、英伟达 AI GPU 交付周期从 8-11 月缩短至 3-4 个月；
- 23、魅族宣布停止传统智能手机新项目，全部投入 AI；
- 24、小米北京昌平智能工厂落成投产，年产千万台旗舰手机；
- 25、三星电机将重点投资汽车 MLCC，与日本村田竞争；
- 26、美国政府将向格芯提供 15 亿美元补贴以扩大半导体生产；
- 27、三星、Arm 宣布扩大 2nm GAA 合作；
- 28、海光信息 2023 年净利润超 12.6 亿，同比增加 57.11%；
- 29、ADI Q1 总收入超 25 亿美元，汽车业务持续增长；
- 30、日月光斥资 21 亿元新台币收购英飞凌菲律宾和韩国两座封测厂；
- 31、美国造车新势力 Rivian 将裁员 10%，因忧心电车销量；
- 32、毫末智行获 B1 轮超亿元融资，用于自动驾驶技术研发；

*资料来源：芯八哥公众号

供给端：AI 芯片原厂业绩惊艳，存储市场持续回暖。

表 1：供给端主要厂商动态

产业链	厂商	行情动态	影响/解读
制造与封测	世界先进	Q1 整体稼动率降至 50%，晶圆出货量估季减 6%-8%	供应链持续调整库存
	日月光	斥资 21 亿元新台币收购英飞凌菲律宾和韩国两座封测厂	AI 高端封装需求暴涨
供应商	微芯科技	2024 财年 Q3 净销售额环比下降 21.7%，同比下降 18.6%	客户需求持续降低
	AMD	数据中心部门 AI GPU 销售表现远超预期，有望带动营收翻倍	AI 芯片炙手可热
	慧荣科技	Q4 营收环比增长 17%，超出预期	存储市场持续回暖
	英特尔	多款 CPU 遭德国禁售	或波及笔电 ODM 大厂出货
	瑞萨电子	宣布 59.1 亿美元收购 PCB 设计软件公瑞萨电子司 Altium	关注产业生态整合
	英伟达	去年财报净利润增 700%，数据中心业务增长 4 倍	加速计算和 GenAI 需求激增

资料来源：芯八哥公众号，华强云平台烽火台，天风证券研究所

需求端：AI 技术迎重大突破，服务器淡季不淡。

表 2：需求端主要厂商动态

类别	细分	行情动态	影响/解读
消费电子	智能手机	2023 年中国折叠屏手机市场出货量达 700.7 万台，同比增长 114.5%	利好折叠屏产业链
		塔塔、和硕洽谈在印度泰米尔纳德邦合资建设 iPhone 组装厂	苹果供应商扩大印度业务
		魅族宣布将停止传统“智能手机”新项目，向 AI 领域转型	传统手机厂商押注 AI 手机
汽车	整车	1 月新能源汽车销量 72.9 万辆，同比增长 78.8%(中汽协)	利好新能源汽车产业链
		零跑再度官宣全系降价，综合优惠至高超 4 万元	汽车价格战愈演愈烈
	零部件	预计 2023 年中国车用激光雷达出货量达 71 万台，同比增长约 450%	激光雷达加速上车
		大陆集团将裁员超 7000 人	竞争力欠缺
		现代摩比斯预计 2024 年再将强劲增长	电动化海外订单旺
XR		预计 2030 年市场规模有望达到 3500 亿美元	利好 XR 产业链
服务器		2024 年 Q1 全球服务器出货有望季增 1.7%，淡季不淡	利好服务器产业链
AI		OpenAI 发布文本生成影像模型 Sora	或迎商业落地突破

资料来源：芯八哥公众号，华强云平台烽火台，天风证券研究所

热门品牌分析：村田滤波器缺货涨价持续，ST 微控制器回升。

表 3：本周热门品牌及料号分析

品牌	料号	品类	应用领域	热度	库存	价格	影响
MURATA/村田	DLW5BTM10 1SQ2L	滤波器	直流-直流转换器和电源线 路设备等	高	下降	337%	工厂停产，缺货 涨价
INFINEON/英 飞凌	BTS50085-1T MA	电源管理芯片	汽车电子、工业控制和电源 管理等	高	稳定	-29.6 0%	需求下降，价格 回落
MICROCHIP/ 微芯	KSZ8999I	以太网交换机芯 片	各种网络环境和应用场景	高	稳定	9.54%	需求改善，价格 回升
ST/意法	STM32F103C BT6	微控制器	工业控制、汽车电子、家电 等	高	下降	31.42 %	需求改善，价格 回升

资料来源：芯八哥公众号，华强云平台烽火台，天风证券研究所

芯片现货行情数据：

表 4：芯片现货行情

型号热度榜		型号飙升榜		型号库存波动榜	
型号	型号	型号	库存波动 (个)	型号	库存波动 (个)
BR24	BR24	CT357B1(T1)	↑ 3994000	LM358	↓ 968786
LBZX	LBZX	SSM3K15AMFV	↓ 3336351	DLW5BTM501SQ2L	↓ 1084000
STM32F103C8T6	STM32F103C8T6	AOZ8671BDT-03	↓ 3120000		
DLW5BTM501SQ2L	LM358	PT4205E89E-AZ	↓ 1084000		
LM358	DLW5BTM501SQ2L	PT4119E89E	↓ 968786		

资料来源：芯八哥公众号，华强云平台烽火台，天风证券研究所

3. 半导体产业宏观数据：半导体销售恢复中高速增长，存储成关键

行业内多家主流机构都比较看好 2024 年的半导体行情。其中，WSTS 表示因生成式 AI 普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现大幅复苏，因此 2024 年全球半导体销售额将增长 13.1%，金额达到 5,883.64 亿美元，再次创历史新高；IDC 的看法比 WSTS 乐观，其认为 2024 年全球半导体销售额将达到 6328 亿美元，同比增长 20.20%；此外，Gartner 也认为 2024 年全球半导体销售额将迎来增长行情，增长幅度将达到 16.80%，金额将达到 6328 亿美元。

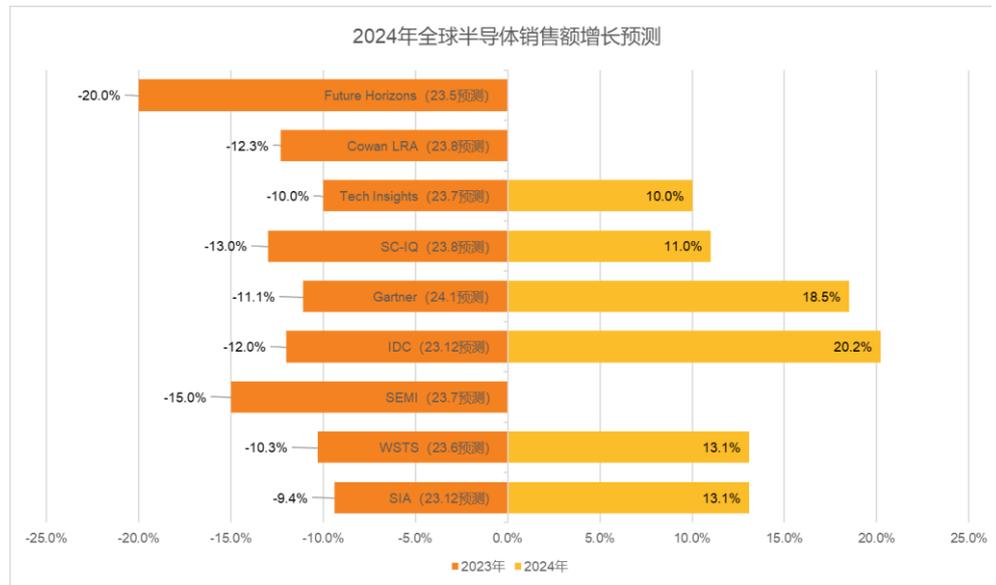
表 5：主流机构对半导体 2024 年的看法

机构名称	2023 年金额(亿 美元)	比例	2024 年金额(亿 美元)	比例
Gartner	5322	-11%	6240	16.80%
WSTS	5201.26	-9.40%	5880	13.10%
IDC	5265	-12%	6328	20.20%

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

从全球半导体销售额看，2023 年半导体行业筑底已基本完成，从 Q3 厂商连续数月的稳定增长或奠定半导体行业触底回升的基础。全球部分主流机构/协会上修 2024 年全球半导体销售额预测，2024 年芯片行业将出现 10%-18.5% 之间的两位数百分比增长。其中，IDC 和 Gartner 最为乐观，分别预测增长达 20.2% 和 18.5%。

图 2：各机构 2024 年全球半导体销售额增长猜测

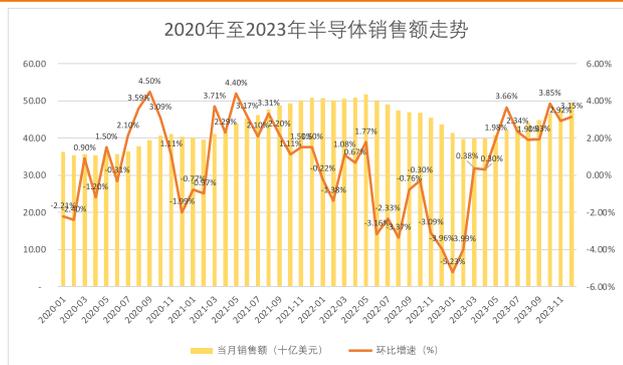


资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

从细分品类看，WSTS 预计 2024 年增速最快的前三名是存储、逻辑和处理器，分别增长 44.8%、9.6%和 7.0%。其他品类中，光电子增速最低，约 1.7%；模拟芯片受库存去化及需求低迷影响，增速约 3.7%。总的来看，存储产品或将成为 2024 年全球半导体市场复苏关键，销售额有望恢复 2022 年水平。

半导体产业宏观数据：美国半导体工业协会（SIA）数据预测，2023 年全球半导体销售额约 5200 亿美元，同比下降 9.4%。值得关注的是，截至 2023 年 12 月全球半导体销售额已连续第十个月实现环比增长，芯片需求呈现出明显的回升势头，预计全球半导体市场在 2024 年将强劲反弹。

图 3：全球半导体销售额



资料来源：SIA，芯八哥公众号，天风证券研究所

图 4：中国集成电路产量



资料来源：工信部、SIA、芯八哥公众号，天风证券研究所

半导体指数走势：2024 年 1 月，中国半导体（SW）行业指数下降 22.98%，费城半导体指数（SOX）上升 5.91%。

图 5：中国半导体（SW）行业指数

图 6：费城半导体指数（SOX）



资料来源: Wind, 天风证券研究所

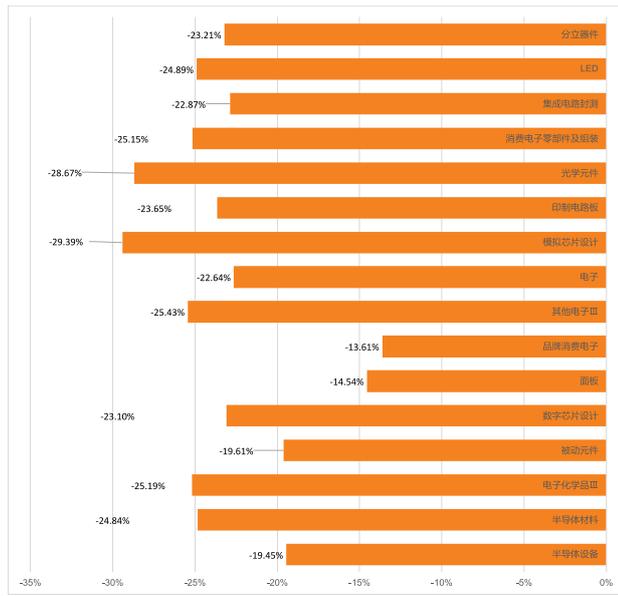


资料来源: Wind, 天风证券研究所

半导体细分板块: 2024 年 1 月, 申万指数各电子细分板块大幅下跌。涨幅居前三名分别为品牌消费电子 (-13.61%)、面板 (-14.54%) 和半导体设备 (19.45%)。跌幅居前三名分别为模拟芯片设计 (-29.39%)、光学元件 (-28.67%) 和其他电子 (-25.43%)。

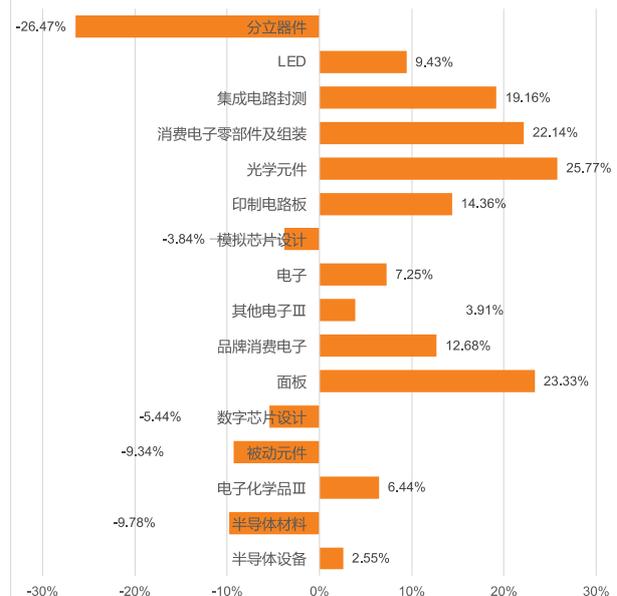
2023 年全年, 申万指数各电子细分板块大多上涨。涨幅居前三名分别为光学元件(25.77%)、面板(23.33%)和消费电子零部件及组装(22.14%)。有所下跌的板块为分立器件(-26.47%)、半导体材料(-9.78%)、被动元件(-9.34%)、数字芯片设计(-5.44%)和模拟芯片设计(-3.84%)等。

图 7: 电子 (申万) 各版块涨跌幅 (24 年 1 月)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

图 8: 电子 (申万) 各版块涨跌幅 (2023 全年)

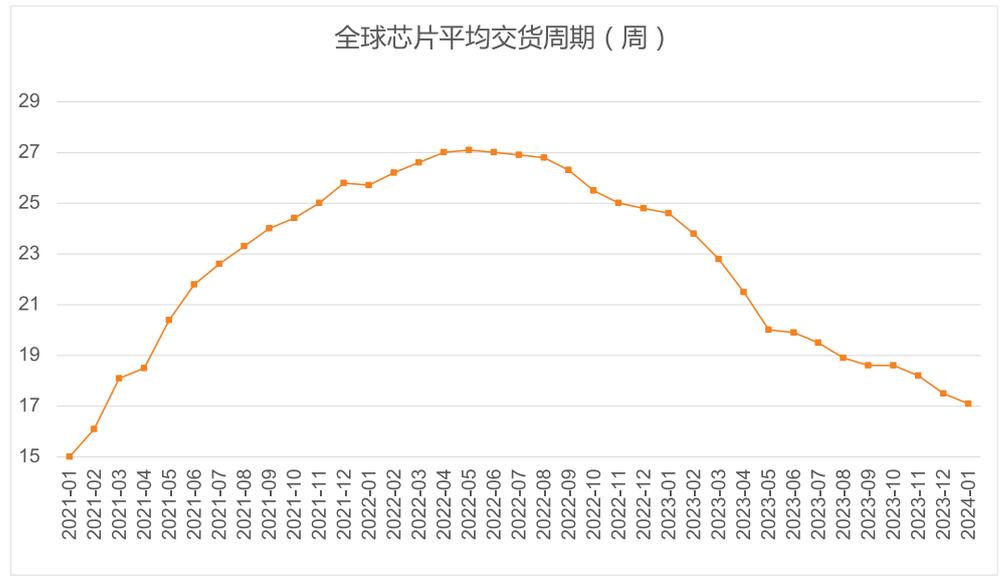


资料来源: Wind, 天风证券研究所

4. 芯片交期及库存: 全球芯片交期持续改善, 需求复苏下行业重回上升周期

整体芯片交期趋势: 1 月, 全球芯片交期持续改善, 但行业库存仍有调整, 部分细分品类交期波动明显。

图 9: 全球芯片平均交货周期 (周)



资料来源：芯八哥公众号，Susquehanna Financial Group，天风证券研究所

重点芯片供应商交期：从1月各供应商看，PMIC等模拟芯片、部分MCU等价格持续倒挂，MOSFET、IGBT等功率器件交期持续改善，地震影响下村田部分电容交期和价格波动明显，存储价格持续回升。

表6：头部厂商1月交期及趋势

类别	供应商	产品	1月交期/周	2月交期/周	交期趋势	价格趋势
模拟	AMS OSRAM	传感器	8-24	8-24	稳定	根据市场调整
	BOSCH	传感器	6-12	6-12	稳定	稳定
	Diodes	多源模拟/电源	20-32	20-32	稳定	稳定
		开关稳压器	20-45	20-45	稳定	稳定
	FTDI Chip	接口	14-24	14-24	缩短	稳定
	Infineon	传感器	18-52	18-52	稳定	上升
		开关稳压器	20-52	20-52	稳定	稳定
		汽车模拟和电源	45-52	45-52	稳定	稳定
	ADI (Maxim)	放大器和数据转换器	15-30	15-30	缩短	上升
		接口	18-30	18-30	缩短	上升
		开关稳压器	20-30	20-30	缩短	稳定
	Microchip	放大器和数据转换器	4-10	4-10	缩短	稳定
		定时	7-12	7-12	缩短	稳定
		开关稳压器	4-25	4-25	缩短	上升
	MPS	开关稳压器	20-42	20-42	缩短	稳定
	NXP	传感器	16-52	16-52	稳定	稳定
		接口	20-30	20-30	缩短	稳定
		汽车模拟和电源	24-35	24-35	缩短	稳定
	On Semi	传感器	18-52	18-52	稳定	根据市场调整
		放大器和数据转换器	18-26	18-26	缩短	稳定
定时		20-42	20-42	稳定	稳定	
多源模拟/电源		20-40	20-40	稳定	稳定	
开关稳压器		20-40	20-40	稳定	上升	
Panasonic	传感器	16-26	16-26	延长	稳定	
Renesas	放大器和数据转换器	24-36	24-36	缩短	稳定	

		定时	50	50	稳定	稳定
		接口	24-36	24-36	缩短	稳定
		开关稳压器	20-40	20-40	稳定	稳定
	ROHM	传感器	24-52	24-52	延长	上升
		开关稳压器	20-40	20-40	稳定	稳定
	ST	传感器	12-18	12-18	缩短	稳定
		放大器和数据转换器	14-24	14-24	缩短	稳定
		多源模拟/电源	20-42	20-42	缩短	稳定
		开关稳压器	20-40	20-40	缩短	稳定
	TE	汽车模拟和电源	40-52	40-52	稳定	稳定
Vishay	传感器	16-52	16-52	稳定	根据市场调整	
射频 和无线	Infineon	传感器	24-52	24-52	延长	稳定
	Microchip	蓝牙模块	26-36	26-36	稳定	稳定
		WiFi 模块	16-26	16-26	缩短	稳定
		蓝牙模块	12-26	12-26	稳定	稳定
	Murata	收发器/接收器	18-20	18-20	稳定	上升
		WiFi 模块	26-50	26-50	稳定	稳定
	Laird	蓝牙模块	26-50	26-50	稳定	稳定
		WiFi 模块	20-40	20-40	稳定	稳定
	ST	天线	12-16	12-16	延长	稳定
		蓝牙模块	10-12	10-12	稳定	稳定
		收发器/接收器	12	12	稳定	稳定
	NXP	RFID	20	20	稳定	稳定
		收发器/接收器	12	12	稳定	稳定
		RFID	20	20	稳定	稳定
On Semi	大功率 IC	12-16	12-16	稳定	稳定	
分立 器件	Diodes	蓝牙模块	16-30	16-30	稳定	稳定
		低压 MOSFET	8-16	8-16	缩短	根据市场调整
		TVS 二极管	8-14	8-14	缩短	稳定
		桥式整流器	8-30	8-15	稳定	稳定
		肖特基二极管	14-20	8-12	缩短	稳定
		整流器	8-30	8-13	稳定	稳定
		开关二极管	12-20	8-12	稳定	稳定
		小信号 MOSFET	12-30	8-12	缩短	稳定
		齐纳二极管	12-20	8-12	稳定	稳定
		双极晶体管	12-20	8-12	缩短	稳定
		数字晶体管/RETS	12-20	8-12	缩短	稳定
	Infineon	通用晶体管	12-20	8-12	缩短	稳定
		逻辑器件	8-10	8-10	稳定	稳定
		低压 MOSFET	10-36	10-36	缩短	根据市场调整
		高压 MOSFET	12-40	12-40	缩短	稳定
		IGBT	14-52	14-52	稳定	稳定
		宽带隙 MOSFET	26-52	26-52	稳定	稳定
		数字晶体管/RETS	6-50	6-50	稳定	稳定
通用晶体管	6-50	6-50	稳定	稳定		
	军用-航空晶体管	22-52	22-52	稳定	稳定	

	ST	低压 MOSFET	50-54	50-54	缩短	稳定
		高压 MOSFET	14-40	14-40	缩短	稳定
		IGBT	14-52	14-52	缩短	稳定
		ESD	21-32	21-32	缩短	稳定
		宽带隙 MOSFET	42-52	42-52	稳定	稳定
		晶闸管/Triac	15-16	15-16	稳定	稳定
		TVS 二极管	25-30	25-30	稳定	根据市场调整
		整流器	14-16	14-16	稳定	稳定
		双极晶体管	40-52	40-52	稳定	稳定
	Wingtech(Nexperia)	低压 MOSFET	4-20	4-20	缩短	根据市场调整
		ESD	6-18	6-18	稳定	稳定
		肖特基二极管	4-16	4-16	缩短	稳定
		开关二极管	4-16	4-16	缩短	稳定
		小信号 MOSFET	8-16	8-16	缩短	稳定
		齐纳二极管	4-16	4-16	缩短	稳定
		双极晶体管	4-16	4-16	缩短	稳定
		数字晶体管/RETS	4-16	4-16	缩短	稳定
		通用晶体管	4-16	4-16	缩短	稳定
	MCU	Renesas	8 位 MCU	12-18	12-18	缩短
32 位 MCU			18	18	缩短	稳定
汽车			45	45	稳定	稳定
32 位 MPU			18-26	18-26	稳定	稳定
ST		8 位 MCU	35-52	10-24	缩短	稳定
		汽车	40-52	40-52	稳定	稳定
		32 位 MPU	16-20	16-20	缩短	稳定
		STM32FO	10-12	10-12	缩短	稳定
		STM32F1	16-20	16-20	缩短	稳定
		STM32L	16-20	16-20	缩短	稳定
		32 位 MCU	20-28	10-20	缩短	稳定
Infineon		8 位 MCU	10-14	10-14	缩短	稳定
		32 位 MCU	10-52	10-52	缩短	稳定
		汽车	紧缺	紧缺	稳定	稳定
Microchip		8 位 MCU	4-16	4-16	缩短	稳定
		32 位 MCU	4-28	4-28	缩短	稳定
		32 位 MPU	4-24	4-24	稳定	稳定
NXP		8 位 MCU	13-39	13-39	缩短	稳定
		32 位 MCU	13-39	13-39	缩短	稳定
	汽车	18-52	18-52	稳定	稳定	
	32 位 MPU	18-52	18-52	缩短	稳定	
可编程逻辑器件	AMD (Xilinx)	FPGA	20-50	20-50	缩短	稳定
	Intel (Altera)		30-55	20-35	稳定	稳定
	Lattice		28-42	20-30	缩短	稳定
	Microchip(Microsemi)		10-44	10-44	缩短	稳定
存储器	Samsung	DRAM(商用 PC)	52-54	52-54	稳定	稳定
		存储器模块	52-54	52-54	稳定	稳定

	SK Hynix	eMMC	52-54	52-54	稳定	稳定
		固态驱动器(SSD)	52-54	52-54	稳定	稳定
		NAND flash	6-10	6-10	缩短	根据市场调整
		eMMC	8-12	8-12	稳定	稳定
被动元件	Murata	滤波器	12-16	12-16	稳定	稳定
		电感/变压器	12-20	12-20	稳定	稳定
		引线陶瓷电容	16-18	16-18	稳定	稳定
		专用电容	15-16	15-16	稳定	稳定
	TDK	滤波器	12-16	12-16	延长	稳定
		电感/变压器	16-20	16-20	稳定	稳定
		表面贴装通用陶瓷电容(车规级)	30-42	30-42	稳定	稳定

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

头部企业订单及库存情况：从企业订单需求看，整体市场需求复苏缓慢，厂商订单相对疲软，库存波动明显。

图 10：头部厂商 1 月订单及库存

公司	1月订单	1月库存	2月订单趋势	2月库存趋势
Intel	稳定	一般	稳定	一般
AMD	稳定	一般	稳定	一般
NVIDIA	上升	无	上升	无
三星	稳定	一般	上升	一般
TI	稳定	较高	根据市场调整	较高
ST	稳定	低	根据市场调整	一般
ADI	稳定	低	上升	一般
Qualcomm	稳定	一般	根据市场调整	一般
Broadcom	稳定	一般	根据市场调整	低
NXP	稳定	低	根据市场调整	较低
Infineon	上升	低	根据市场调整	较低
Renesas	稳定	低	根据市场调整	一般
Onsemi	稳定	低	稳定	低
Microchip	稳定	一般	稳定	一般
Micron	稳定	一般	上升	一般
SK Hynix	稳定	一般	上升	一般
Murata	稳定	低	稳定	稳定
联发科	稳定	一般	根据市场调整	一般

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

2023 年第四季度，国际及中国台湾代工、存储板块公司存货周转天数同比下降，分别为 -2.43%， -4.31%。逻辑、模拟板块公司存货周转天数同比上升，分别为 +21.55%， +34.13%

图 11：国际及中国台湾主要半导体厂商存货周转天数

代工	公司	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2	20Q3	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4	22Q1	22Q2	22Q3	22Q4	23Q1	23Q2	23Q3	23Q4	23Q3平均	同比变化(%)
逻辑	台积电	61	53	49	51	54	68	77	80	80	83	82	87	82	86	89	93	91	80	86	-2.43%
	英特尔	81	86	90	100	99	80	76	68	74	72	77	72	86	107	135	146	159	144		
	三星	97	91	81	123	134	118	109	101	115	114	111	114	118	117	139	138	145	153	152	
	联发科	100	98	101	97	98	93	92	94	101	105	104	128	129	139	138	145	153	152		
	台积电	16	15	16	17	17	18	21	24	25	22	22	21	24	22	21	21	21	20	17	
	联发科	85	115	76	88	89	85	75	68	75	72	77	68	89	111	127	132	115	98		
	三星	111	112	108	106	98	84	81	89	84	83	84	87	84	106	128	131	152	152		
	联发科	102	106	109	104	94	87	81	89	84	83	84	87	84	106	128	131	152	152		
	台积电	86	87	82	87	78	68	68	75	75	78	81	88	113	128	131	162	158	138		
	联发科	100	89	97	93	91	87	85	86	95	83	81	83	99	104	105	105	102	102		
三星	76	89	73	77	80	74	71	74	80	81	82	86	104	104	104	120	120	107			
联发科	105	105	105	117	111	105	95	86	95	94	97	101	95	94	116	116	122	130	130		
台积电	144	147	147	155	150	139	131	126	121	118	121	123	123	129	150	179	197	205	221		
三星	88	78	78	83	85	93	78	83	82	88	75	84	88	104	86	100	102	102			
联发科	110	112	115	120	116	112	111	112	118	82	77	74	107	118	129	137	143				
台积电	91	95	94	104	109	79	88	105	97	99	86	73	97	89	98	94	124	122	96		
三星	115	115	133	134	138	109	100	116	114	111	114	118	117	139	138	145	153	152			
联发科	135	127	125	125	126	123	120	116	115	114	117	118	131	145	157	166	169	188			
台积电	102	106	109	104	99	92	91	86	84	81	84	87	94	126	138	151	152	152			
三星	125	127	127	132	131	128	128	124	120	119	126	129	126	136	148	156	160	181			
联发科	94	92	88	100	89	86	88	89	85	94	98	105	125	164	158	163	181	181			
台积电	117	116	108	118	117	115	117	112	107	108	102	103	207	207	231	234	241	267			
三星	113	115	118	120	128	118	113	115	119	107	111	123	143	164	184	187	185	139			
联发科	103	103	108	117	111	105	86	86	85	84	87	101	95	88	116	122	116	130			
台积电	110	118	124	122	123	125	127	127	124	134	130	135	131	223	157	141	158				
三星	144	147	147	155	150	139	131	126	121	118	121	123	129	150	179	197	205	221			
联发科	86	82	77	78	111	79	87	83	85	91	93	99	97	97	103	117	121	125			
台积电	247	223	212	211	211	210	188	180	172	157	147	147	170	246	420	368	406	404	106		
三星	236	211	196	188	189	178	167	171	164	161	168	160	190	218	281	261	269	286			
联发科	185	177	175	125	126	123	120	116	115	114	117	118	131	145	157	165	169	188			
台积电	125	122	126	131	128	120	112	107	104	109	109	108	135	214	153	168	188	170	150		
三星	147	137	136	147	138	130	117	104	96	97	94	104	203	267	188	188	266	188			
联发科	75	71	71	77	80	74	71	74	80	81	83	104	104	104	104	120	109	107			
台积电	84	84	88	101	100	98	97	81	100	114	123	125	171	184	200	189	188	188			
三星	97	92	86	95	100	107	116	136	153	161	160	184	171	186	123	121	149	129			
联发科	81	79	70	83	84	83	87	83	82	88	78	84	89	104	86	110	102				
台积电	81	81	82	82	80	81	87	87	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138			
三星	110	108	107	106	116	105	95	85	85	85	96	102	107	148	160	154	156	157	158		

资料来源: Capital IQ, Wind, 天风证券研究所

2023 年第三季度, 中国大陆 IDM 板块公司存货周转天数同比小幅下降, 其余各环节公司存货周转天数同比增加。封测、代工、装备、IDM、材料、设计各板块公司平均存货周转天数分别为 57 天、153 天、586 天、148 天、116 天和 253 天, 同比分别为 +10.66%, +25.34%, +23.49%, -5.34%, +31.32%和+9.72%。

图 12: 中国大陆主要半导体厂商存货周转天数

存货周转天数	公司	19Q3	19Q4	20Q1	20Q2	20Q3	20Q4	21Q1	21Q2	21Q3	21Q4	22Q1	22Q2	22Q3	22Q4	23Q1	23Q2	23Q3	23Q4	23Q3平均	同比变化(%)	
封测	中天科技	67	70	72	68	69	60	66	64	65	50	61	62	61	61	61	63	76	80	57	10.66%	
	通富微电	73	87	95	78	60	47	51	47	50	46	53	53	52	55	91	92	71				
	长电科技	35	37	49	45	47	42	45	44	46	45	45	52	48	41	50	48	48	56	56		
	新洁能																					
代工	华利半导体	91	91	85	85	73	82	80	91	100	102	103	106	117	123	157	163	165			153	25.34%
	华力半导体	512	387	562	462	381	321	577	466	426	314	824	1022	714	680	1121	980	987				
	中微公司	581	202	369	219	335	224	293	291	341	271	340	367	458	334	492	472	469				
	北方华创												858	852	803	642	613	639				
设备	北方华创	184	207	103	328	382	178	240	180	318	234	255	337	310	339	460	413	562	544	586	23.49%	
	盛美上海										461	775	775	470	418	548	548	562	604			
	正科技																					
	至纯科技	321	245	888	237	404	183	554	169	281	208	396	308	248	300	752	362	441				
IDM	士兰微	183	161	250	188	145	113	121	102	111	117	154	155	164	165	165	159	157	165			
	华润微电子	89	78	98	88	87	76	82	75	76	90	87	86	99	97	115	101	107				
	紫光集团	211	158	250	236	244	154	185	136	156	146	187	160	206	173	218	148	171				
	中芯国际	94	94	98	101	100	98	97	81	100	114	123	125	171	184	200	189	188				
材料	有源新材	20	21	34	22	31	23	28	31	28	31	29	44	26	27	44	44	46	48			
	雅克科技	96	104	109	100	78	116	81	89	103	87	116	105	129	122	146	127	146				
	纳芯微											132	168	141	122	161	179	224	395	342		
	聚源新材													82	76	64	67	84	115	112		
设计	平利股份	93	89	200	174	121	108	125	110	137	99	121	99	194	152	206	210	234				
	瑞芯微	125	102	177	111	76	64	68	53	83	98	154	156	466	276	609	394	409				
	蓝微电子	121	92	158	100	53	39	52	69	93	101	109	116	138	134	197	118	159				
	芯海电子	110	87	98	77	62	39	81	38	73	88	80	109	115	223	339	283	291				
芯原股份	83	120	169	180	132	112	118	127	163	189	245	273	418	344	319	242	226					

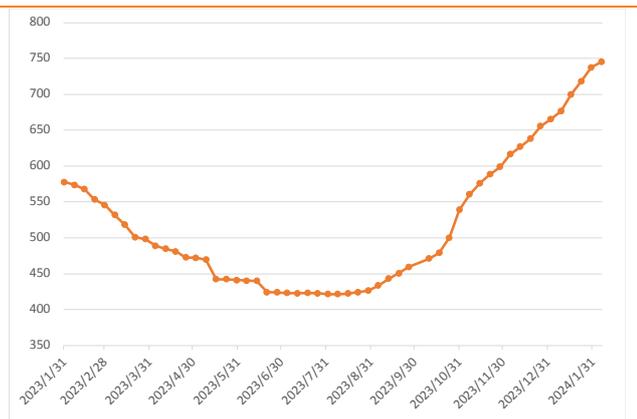
资料来源: Wind, Capital IQ, 天风证券研究所

5. 产业链各环节景气度:

5.1. 设计: 库存去化效益显现, 需求复苏有望带动基本面持续向好

5.1.1. 存储: 周期已触底反弹, NAND 价格短期内或再涨 50%

根据闪存市场公众号对存储行情的周报(截至 2024.02.20)评述, 本周上游资源方面, 节后 NAND 资源暂未见明显变化, DDR4 小幅上涨。渠道市场方面, 渠道部分品牌价格微涨, 本周渠道价格小幅上行, 节后市场买气有待恢复。行业市场方面, 行业市场未见明显变化, 本周



资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所



资料来源：闪存市场官网，天风证券研究所

上游资源方面,节后 NAND 资源暂未见明显变化,DDR4 小幅上涨。DDR4 16Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT/4Gb eTT 价格分别为 3.10/2.60/1.50/1.25/0.75 美元。

图 15: Flash Wafer 最新报价 (当前价为美元)

产品名称	当前价	前收盘	涨跌
1Tb QLC	6.00	6.00	0.00% 0.00
1Tb TLC	6.60	6.60	0.00% 0.00
512Gb TLC	3.35	3.35	0.00% 0.00
256Gb TLC	1.80	1.80	0.00% 0.00

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 16: DDR 最新报价 (当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 16Gb 3200	3.10	3.05	1.64% 0.05
DDR4 16Gb eTT	2.60	2.55	1.96% 0.05
DDR4 8Gb 3200	1.50	1.50	0.00% 0.00
DDR4 8Gb eTT	1.25	1.20	4.17% 0.05
DDR4 4Gb eTT	0.75	0.73	2.74% 0.02

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

渠道市场方面,渠道部分品牌价格微涨,本周渠道价格小幅上行,节后市场买气有待恢复。行业市场方面,行业市场未见明显变化,本周价格持平不变。

图 17: 渠道市场 SSD 最新报价 (当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
SSD 120GB SATA 3	8.60	8.40	2.38% 0.20
SSD 240GB SATA 3	14.40	14.00	2.86% 0.40
SSD 480GB SATA 3	24.40	24.00	1.67% 0.40
SSD 256GB PCIe 3.0	15.60	15.40	1.30% 0.20
SSD 512GB PCIe 3.0	26.60	26.30	1.14% 0.30
SSD 1TB PCIe 3.0	48.70	48.50	0.41% 0.20
SSD 512GB PCIe 4.0	36.20	36.00	0.56% 0.20
SSD 1TB PCIe 4.0	53.20	51.00	4.31% 2.20
SSD 2TB PCIe 4.0	100.00	96.00	4.17% 4.00

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 18: 行业市场 SSD 最新报价 (当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
SSD 256GB SATA 3	18.00	18.00	0.00% 0.00
SSD 512GB SATA 3	32.00	32.00	0.00% 0.00
SSD 1TB SATA 3	55.00	55.00	0.00% 0.00
SSD 256GB PCIe 3.0	20.50	20.50	0.00% 0.00
SSD 512GB PCIe 3.0	35.50	35.50	0.00% 0.00
SSD 1TB PCIe 3.0	61.00	61.00	0.00% 0.00
SSD 512GB PCIe 4.0	36.50	36.50	0.00% 0.00
SSD 1TB PCIe 4.0	64.00	64.00	0.00% 0.00
SSD 2TB PCIe 4.0	110.00	110.00	0.00% 0.00

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

图 19: 渠道市场内存条最新报价 (当前价为美元)

图 20: 行业市场内存条最新报价 (当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 UDIMM 8GB 3200	13.40	13.20	1.52%
			0.20
DDR4 UDIMM 16GB 3200	24.00	23.80	0.84%
			0.20
DDR4 UDIMM 32GB 3200	48.40	48.00	0.83%
			0.40

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

产品名称	本周价	上周价	涨跌
DDR4 SODIMM 4GB 3200	10.00	10.00	0.00%
			0.00
DDR4 SODIMM 8GB 3200	16.30	16.30	0.00%
			0.00
DDR4 SODIMM 16GB 3200	27.50	27.50	0.00%
			0.00

资料来源：闪存市场公众号，天风证券研究所

嵌入式市场方面，嵌入式价格暂持平不变，观察市场供需进一步动向。

图 21: eMMC 最新报价 (当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
eMMC 8GB 5.1	2.00	2.00	0.00% 0.00
eMMC 16GB 5.1	2.60	2.60	0.00% 0.00
eMMC 32GB 5.1	2.85	2.85	0.00% 0.00
eMMC 64GB 5.1	4.50	4.50	0.00% 0.00
eMMC 128GB 5.1	7.80	7.80	0.00% 0.00
eMMC 256GB 5.1	16.50	16.50	0.00% 0.00

资料来源: 闪存市场公众号, 天风证券研究所

图 23: UFS 最新报价 (当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
UFS 64GB	5.00	5.00	0.00% 0.00
UFS 128GB	8.50	8.50	0.00% 0.00
UFS 256GB	17.50	17.50	0.00% 0.00

资料来源: 闪存市场公众号, 天风证券研究所

图 22: LPDDR 最新报价 (当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
LPDDR4X 96Gb	26.50	26.50	0.00% 0.00
LPDDR4X 64Gb	19.50	19.50	0.00% 0.00
LPDDR4X 48Gb	13.30	13.30	0.00% 0.00
LPDDR4X 32Gb	8.20	8.20	0.00% 0.00
LPDDR4X 16Gb	3.60	3.60	0.00% 0.00
LPDDR4X 8Gb	2.30	2.30	0.00% 0.00

资料来源: 闪存市场公众号, 天风证券研究所

图 24: uMCP 最新报价 (当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
uMCP(LPDDR4X+UFS2.2) 4GB+128GB	17.00	17.00	0.00% 0.00
uMCP(LPDDR4X+UFS2.2) 6GB+128GB	22.50	22.50	0.00% 0.00
uMCP(LPDDR4X+UFS2.2) 8GB+128GB	28.00	28.00	0.00% 0.00
uMCP(LPDDR4X+UFS2.2) 8GB+256GB	39.00	39.00	0.00% 0.00

资料来源: 闪存市场公众号, 天风证券研究所

图 25: eMCP 最新报价 (当前价为美元)

产品名称	本周价	上周价	涨跌
eMCP(eMMC+LPDDR4X)64GB+32Gb	13.20	13.20	0.00% 0.00
eMCP(eMMC+LPDDR4X)128GB+32Gb	17.00	17.00	0.00% 0.00
eMCP(eMMC+LPDDR4X)128GB+48Gb	22.50	22.50	0.00% 0.00

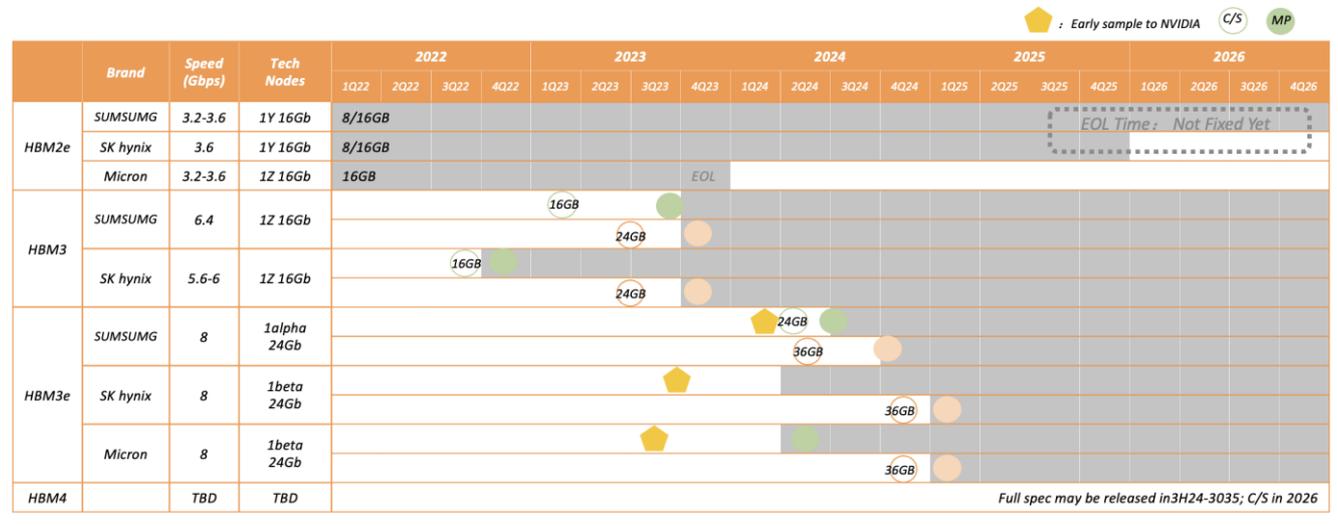
资料来源: 闪存市场公众号, 天风证券研究所

NVIDIA H200 发布催化 HBM 发展: 英伟达发布全新 H200 GPU 及更新后的 GH200 产品线。相比 H100, H200 首次搭载 HBM3e, 运行大模型的综合性能提升 60%-90%。而新一代的 GH200 依旧采用 CPU+GPU 架构, 也将为下一代 AI 超级计算机提供动力。HBM3E 是市场上最先进的高带宽内存(HBM)产品, HBM 即为高带宽内存(High Bandwidth Memory), 是一种基于 3D 堆栈工艺的高性能 DRAM, 通过增加带宽, 扩展内存容量, 让更大的模型, 更多的参数留在离核心计算更近的地方, 从而减少内存和存储解决方案带来的延迟、降低功耗。HBM 的高带宽相当于把通道拓宽, 让数据可以快速流通。因此面对 AI 大模型千亿、万亿级别的参数, 服务器中负责计算的 GPU 几乎必须搭载 HBM。英伟达创始人黄仁勋也曾表示, 计算性能扩展的最大弱点是内存带宽, 而 HBM 的应用打破了内存带宽及功耗瓶颈。在处理 Meta 的大语言模型 Llama2 (700 亿参数) 时, H200 的推理速度比 H100 提高了 2 倍, 处理高性能计算的应用程序上有 20%以上的提升, 采用 HBM3e, 完成了 1.4 倍内存带宽和 1.8 倍内存容量的升级。

HBM 的制程发展: 目前市场上最新 HBM3E, 即第 5 代 HBM, 正搭载在英伟达的产品中。随着 AI 相关需求的增加, 第六代高带宽存储器 HBM4 最早将于 2026 年开始量产。据韩媒报道, SK 海力士已开始招聘 CPU 和 GPU 等逻辑半导体设计人员。SK 海力士希望 HBM4

堆栈直接放置在 GPU 上，从而将存储器和逻辑半导体集成在同一芯片上。这不仅会改变逻辑和存储设备通常互连的方式，还会改变它们的制造方式。如果 SK 海力士成功，这可能会在很大程度上改变部分半导体代工的运作方式。

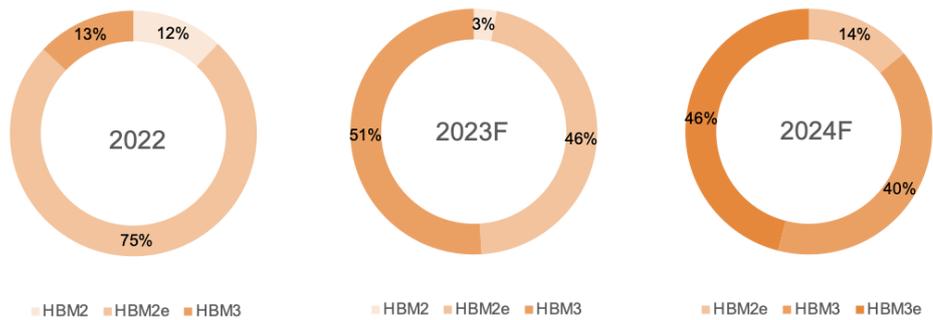
图 26: HBM 制程发展



资料来源: TrendForce, MTS2024 存储产业趋势研讨会, 天风证券研究所

HBM 迭代进程: 2024 年 HBM2、HBM2e 和 3e 的市场份额会发生比较明显的改变。2023 上半年主流还是 HBM2e, 但是因为 H100 的问世, 下半年 HBM3 就成为市场主流, 很快 2024 年就会进行到 HBM3e, 因为它堆叠的层数更高, 所以平均单价一定要比现在再高 20%-30% 以上, 所以它对产值的贡献会更明显。

图 27: HBM 比重转进 (依位元计算)



资料来源: TrendForce, MTS2024 存储产业趋势研讨会, 天风证券研究所

2024 年存储下游需求预判: 对于 PC、移动、汽车和工业领域大多数客户来说, 存储库存已经处于或接近正常水平。数据中心客户的存储产品库存正在改善, 美光预计客户库存将在 2024 年上半年的某个时候接近该市场的正常水平。另外, 在数据中心和 PC 市场中, DRAM 产品正逐渐过渡到 DDR5, 美光预计在 2024 年初 DDR5 的销量将超越 DDR4。生成式人工智能应用将从数据中心扩展到边缘, 最近市场发布了几款具有 AI 功能的 PC 和智能手机, 另外, 汽车和工业终端市场也将嵌入 AI。边缘设备上的人工智能将进一步增强隐私、降低延迟、提高性能、提供更大的个性化等更多优点。

服务器市场: 2023 年数据中心服务器出货量出现两位数百分比下降后, CFM 闪存市场预计 2024 年服务器总出货量将出现中个位数百分比增长。另一方面, 随着 AI 发展, 服务器客户预算将从传统服务器转移到人工智能服务器。一些客户推出的新款 GPU 和 AI 加速产品路线图显示对高带宽内存(HBM) 容量、性能和功耗的要求不断增加。

PC 市场: CFM 闪存市场预计 PC 销量在连续两年出现两位数百分比下降之后, 到 2024 年

将出现低至中个位数百分比的增长。美光预计 PC OEM 厂商将在 2024 下半年开始增加搭载 AI 的 PC，每台额外增加 4 -8GB DRAM 容量，SSD 平均容量也会增加。

Mobile 市场：在移动领域，智能手机需求显示出复苏迹象，CFM 闪存市场预计 2024 年智能手机出货量将小幅增长。美光预计智能手机 OEM 将在 2024 年开始大量生产支持人工智能的智能手机，每台额外增加 4-8GB DRAM 容量。

汽车和行业市场：工业和汽车市场边缘人工智能的扩散持续增加，对内存需求也将显著增加。CFM 闪存市场预计支持人工智能的工业 PC 的内存容量比标准 PC 将增长 3-5 倍，与标准非 AI 视频摄像机相比，支持 AI 的边缘视频安全摄像机的内存容量增加了 8 倍。

2024 年一季度存储价格预判：24Q1 整体存储市场价格展望乐观，其中 Mobile DRAM 及 NAND Flash (eMMC/UFS) 均价季涨幅将扩大至 18~23%。2024 年第一季存储器价格走势在客户端需求持续，以及原厂仍未拉升稼动的情况下，供需缺口加大，Mobile 存储器涨幅将较其他应用更明显，将成为该季领涨项目。

2024 年第一季度价格预判：1) **NAND：**为避免缺货，买方持续扩大 NAND Flash 产品采购以建立安全库存水位，而供应商为减少亏损，对于推高价格势在必行，预估 2024 年第一季 NAND Flash 合约价季涨幅约 15-20%，其中预期 CSSD 涨幅 15-20%，ESSD 涨幅 18-23%，eMMC UFS 涨幅 18-23%，3D NAND wafers 涨幅 8-13%。2) **DRAM：**2024 年第一季度 DRAM 合约价季涨幅约 13~18%，其中 Mobile DRAM 持续领涨。目前观察，由于 2024 全年需求展望仍不明朗，故原厂认为持续性减产仍有其必要，以维持存储器产业的供需平衡。

图 28：23Q4-24Q1 NAND FLASH 产品合约价涨跌幅预测

	4Q24	1Q24 (E)
Client SSD	up 13-18%	up 15-20%
Enterprise SSD	up 10-15%	up 18-23%
eMMC UFS	up 10-15%	up 18-23%
3D NAND Wafers (TLC & QLC)	up 35-40%	up 8-13%
Total NAND Flash	up 13-18%	up 15-20%

资料来源：全球闪存市场公众号，天风证券研究所

图 29：23Q4-24Q1 DRAM 产品合约价涨跌幅预测

	4Q23	1Q24 (E)
PC DRAM	DDR4: up 8-13% DDR5: up 10-15% Blended ASP: up 10-15%	up 10-15%
Server DRAM	DDR4: up 5-10% DDR5: up 0-5% Blended ASP: up 8-13%	up 10-15%
Mobile DRAM	up 18-23%	up 18-23%
Graphics DRAM	up 8-13%	up 10-15%
Consumer DRAM	up 10-15%	DDR3: up 8-13% DDR4: up 10-15%
Total DRAM	up 13-18%	up 13-18%

资料来源：全球闪存市场公众号，天风证券研究所

CES2024-SK 海力士着重强调存储在 AI 时代发挥关键作用：SK 海力士在拉斯维加斯举行的 CES2024 期间举行了题为“存储，人工智能的力量”的新闻发布会，SK 海力士社长兼 CEO 郭鲁正在会上阐述了 SK 海力士在人工智能时代的愿景。发布会上，郭社长表示，**随着生成人工智能的普及，存储的重要性将进一步提高。**他还表示，“SK 海力士正在向 ICT 行业提供来自世界最佳技术的产品，引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。郭社长在新闻发布会上提到：ICT 行业在 PC、移动和现在基于云的人工智能时代发生了巨大的发展。在整个过程中，各种类型和大量的数据都在生成和传播。现在，我们进入了一个建立在所有数据基础上的 AGI 新时代。因此，新时代将朝着 AGI 不断生成数据并重复学习和进化的市场迈进。**在 AGI 时代，存储将在处理数据方面发挥关键作用。**从计算系统的角度来看，存储的作用甚至更为关键。以前，系统基本上是数据流从 CPU 到内存，然后以顺序的方式返回 CPU 的迭代，但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。现在，人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器，以加速大规模数据处理。这意味着人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。**人工智能时代的存储方向应该是以最快的速度、最有效的方式和更大的容量处理数据。**这与过去一个世纪的存储开发一致，后者提高了密度、速度和带宽。

三星、SK 海力士和美光存储三巨头将极大受益于消费电子的复苏。值得强调的是，在消费电子回暖的带动下，存储芯片在 23Q4 合约价报价优于市场预期。其中，DRAM 方面，DDR5 上涨 15~20%，DDR4 上涨 10~15%，DDR3 上涨 10%，涨幅优于原先预估的 5~10%；而在 NAND Flash 方面，目前每家厂商平均涨至少 20~25%，涨幅比 DRAM 更大。

表 7: 存储厂商受益于手机、PC 服务器复苏

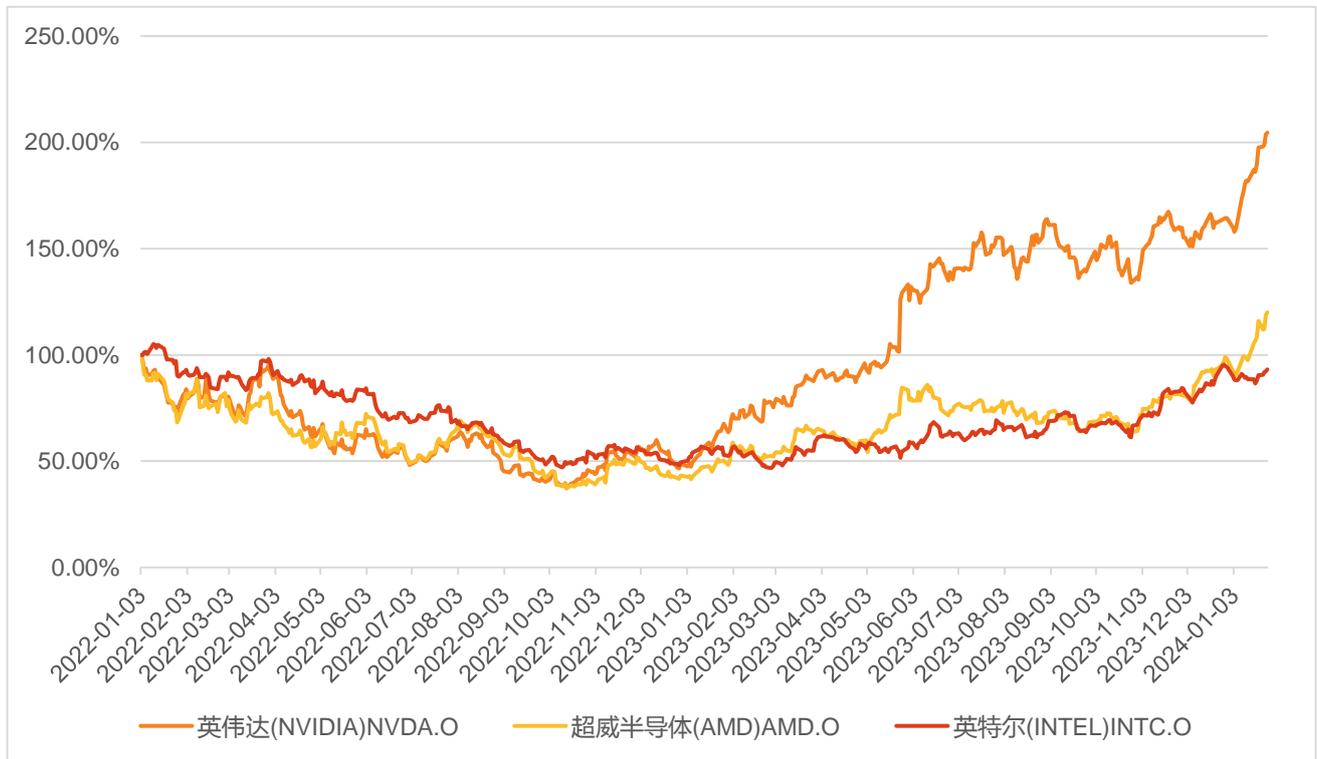
类别	细分品类	企业	业务动态
存储	存储	三星	2024 年半导体投资同比增长 25%；三星电子等 2023 年第四季度向多家大型智能手机公司供应的移动 DRAM 价格上调了 25%至 28%左右，这一幅度超出了市场预期
		美光	Q3 的汽车收入创纪录新高；公司认为 DRAM 需求正在改善，2024 年 HBM 产能已全部售罄；计划 2024 年增加半导体投资，同比增长 100%；公司认为 2024 年和 2025 年存储价格将保持着强劲势头
		SK 海力士	Q3 服务器 DRAM 市场份额近 50%，Q3 销售额中 HBM 的占比达到了 20%；2024 年增加半导体投资，同比增长 100%；公司指出，PC 市场随着渠道库存回归正常水位，加上明年换机需求提升，整体出货量有望实现约 5%增长

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.1.2. 数字芯片：高通发布 MR 设备芯片 XR2+Gen 2，重点关注 XR 市场相关标的

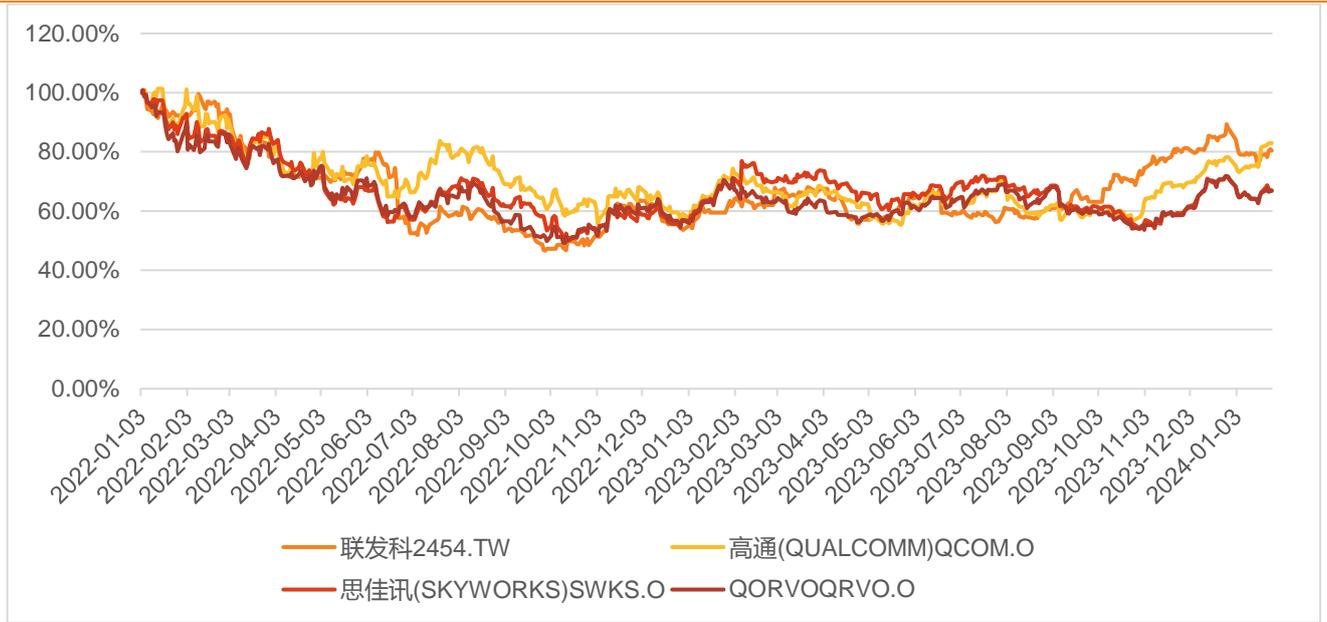
在过去的一个月(12.25-01.25)数字芯片国际厂商股价涨跌不一，其中英伟达/AMD/英特尔股价涨跌幅分别为+25.0%/+25.7%/-1.9%，联发科/高通/Skyworks/Qorvo 股价涨跌幅分别为-5.2%/+7.7%/-5.1%/-5.5%。

图 30: NVIDIA、AMD、INTEL 股价相对涨跌幅



资料来源：Wind，天风证券研究所 注：以 2022/1/3 股价为基准

图 31: 联发科、高通、思佳讯、Qorvo 股价相对涨跌幅



资料来源：Wind，天风证券研究所 注：以 2022/1/3 股价为基准

在计算芯片方面，根据研究机构 Jon Peddie Research 统计，2023 年第三季度，全球 PC GPU 出货量达到 7190 万个，环比增长 16.8%，PC CPU 出货量环比增长 15.2%。PC GPU 市场中，英伟达、英特尔、AMD 出货量均显著增长，其中 AMD 环比增长达 36.6%。市场份额方面，英伟达为 19%，英特尔为 64%，AMD 为 17%。目前个人电脑的 GPU 搭载率为 117%，比上季度增长 1.6%，这显示出搭载独立显卡的 PC 占比增加。此外，台式机独立显卡占比增长了 37.4%。专注智能手机 SoC 的高通、联发科、海思也将极大受益于消费电子的复苏。

表 8：手机、PC、服务器复苏主要受益半导体品类及厂商

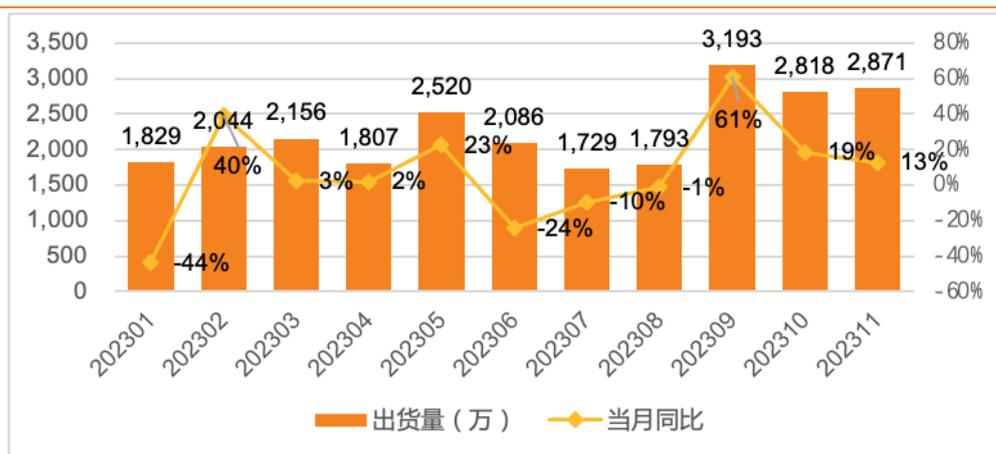
类别	细分品类	企业	业务动态
计算	CPU/GPU	英特尔	英特尔将推出备受期待的 Meteor Lake 芯片，采用 Intel 4 制程工艺，首次引入了针对人工智能加速的 NPU。此外，英特尔还正式启动首个“AI PC 加速计划”
		AMD	AMD Ryzen 8000 系列 AM5 桌面处理器预计将于 2024 年推出。新一代处理器预计将采用基于 Zen 5 架构的 CPU 核心。
		英伟达	英伟达推出三款带有额外组件的新型桌面级 GPU
	手机 SoC	高通	公司看到全球手机需求稳定的早期迹象，预计 2023 年手机销量将同比下降中高个位数百分比，好于此前预期。受益于安卓渠道库存正常化、旗舰新机带动公司新品出货，预 FY24Q1 手机业务营收环比增长超 10%，其中来自中国手机客户的收入环比增长超 35%。
		联发科	Q3 营收季增 12.2%，预计 Q4 营收季增 9~15%；Q3 手机芯片出货量全球市场份额达 33%
		海思	在高端智能手机 Mate 60 系列强势带动下，华为已将智能手机 2024 年出货量目标定为 6000 万台至 7000 万台。在突破美国封锁制裁后，随着海思各大业务逐步回归，海思有望重回全球前十大设计公司行列

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

根据 Counterpoint Research 的《智能手机 360 报告》对全球智能手机出货量的预测，预计 2023 年全球智能手机出货量将同比下降 5%，达到 12 亿台，为近十年最低水平。然而，预计第四季度出货量将同比增长 3%，达到 3.12 亿台。北美和欧洲的出货量预计将与去年持平。但中国和中东和非洲 (MEA)、印度等新兴市场成功扭转颓势，从 2023 年第

四季度起将成为智能手机市场的新增长引擎。

图 32：202301-202311 中国手机出货量（万台，其中 11 月为 BCI 统计中国智能手机新机激活量）



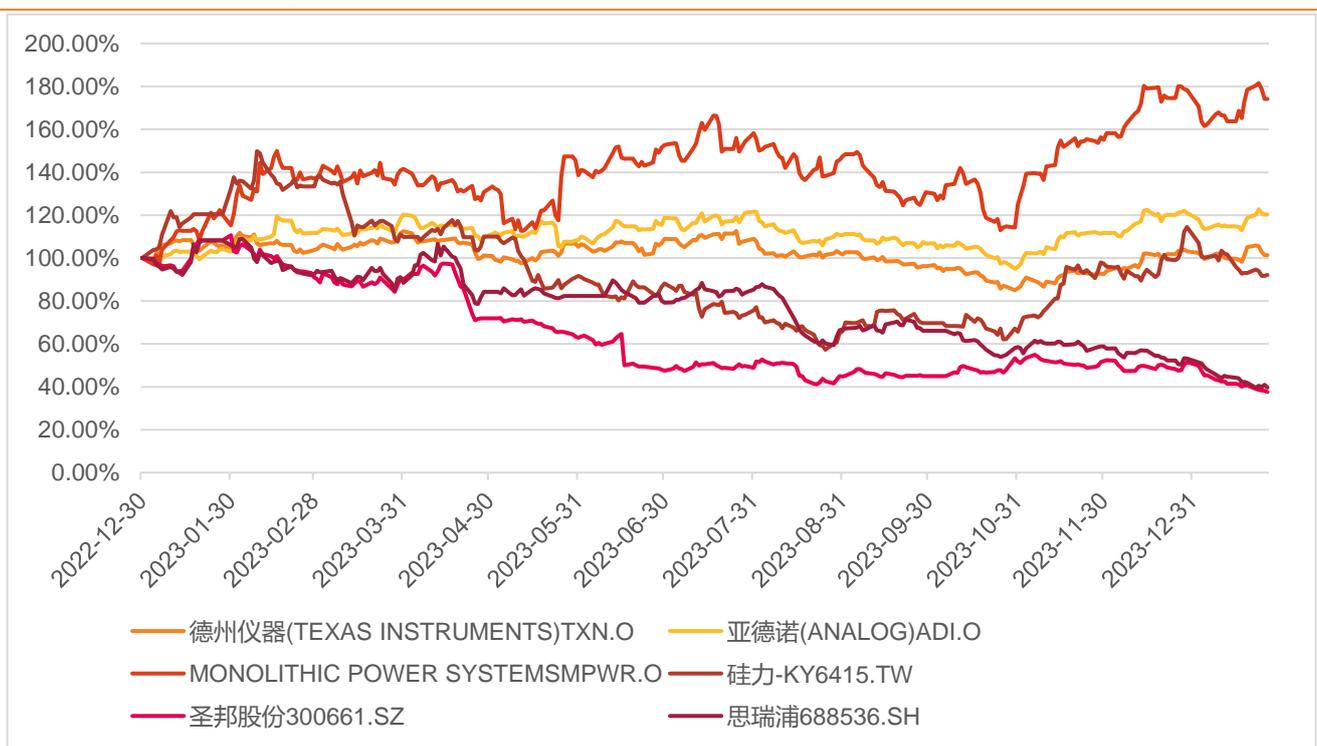
资料来源：Wind，天风证券研究所

5.1.3. 模拟芯片：传 ADI 上调价格，涨价有望潮蔓延至模拟芯片

国际电子商情 2023 年 12 月 28 日讯，近日，有消息称，模拟芯片大厂 ADI（亚德诺半导体）向中国大陆地区经销商发出涨价通知，计划 2024 年 2 月 4 日开始调涨售价，涨幅预计一至两成，此次涨价包括新订单及现有订单。函件内容显示，此次涨幅在 10%-20%，包括新订单及现有预订需求。该公司还给不同时段量产的产品作了区分，如量产 20 年涨幅约在 15%，量产 25 年-30 年涨幅约在 20%。此次涨价体现出 ADI 对产业需求回升的乐观态度。一方面，模拟芯片生命周期相对长，芯片厂往往为了推动、普及新产品等应用，都会对老产品进行涨价，ADI 通过提高旧产品价格，推动客户换新产品；另一方面，也透露出下游需求回升，对未来业绩成长的信心。

在过去的一个月(12.25-01.25)模拟芯片厂商股价下行，大部份厂商股价出现下跌。其中/矽力杰/圣邦股份/思瑞浦近一月股价分别下降 7.3%/21.1%/21.7%。

图 33：TI、ADI、MPS、Silergy、圣邦、思瑞浦股价相对涨跌幅

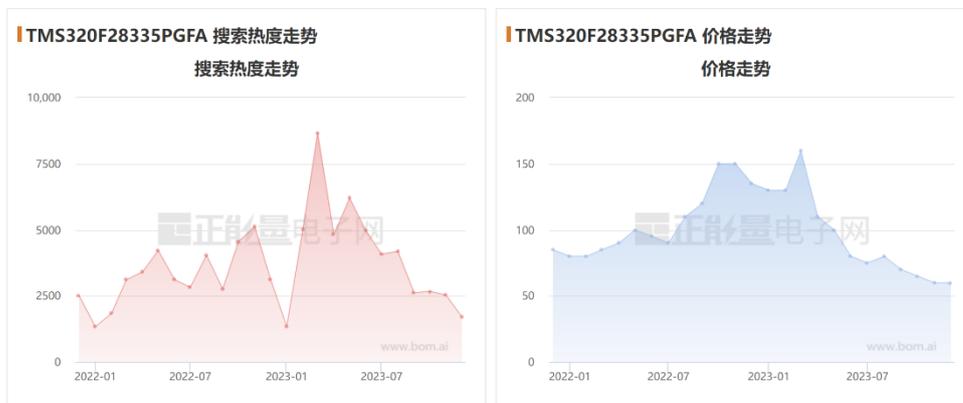


资料来源：Wind，天风证券研究所 注：以 2022/12/30 股价为基准

部分汽车料仍缺货，TI 大部分物料的交期已恢复正常。热门型号 TMS320F28335PGFA 价格

持续下跌，当前现货价格在 60-70 元左右。对于 TI 来说，现货市场整体还是低迷。TI 的逻辑器件和线性器件产品方面，在 8-20 周内供应持续改善。TI 的高速 ADC 系列、高精度运算放大器系列、隔离系列和高压和隔离电源系列产品的供应仍然紧张。另外，TI 对于工业类需求不太看好，目前处于库存调整阶段。

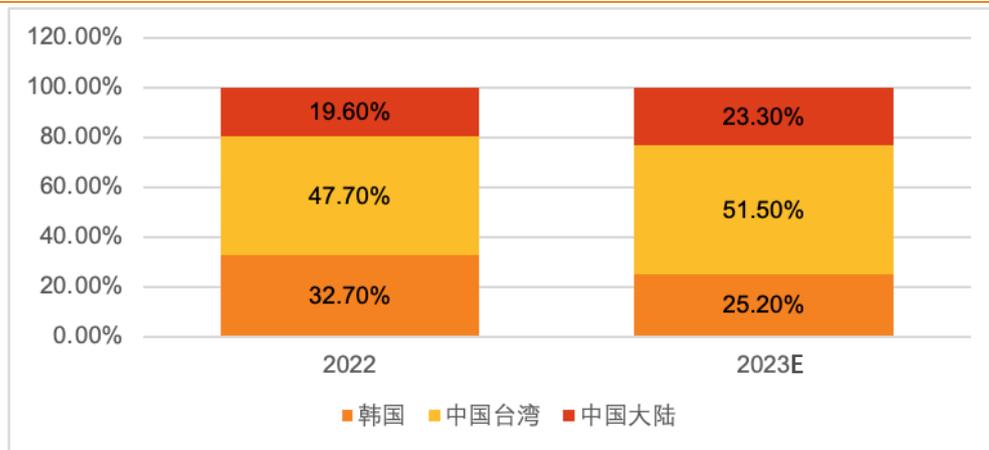
图 34: TMS320F28335PGFA 价格趋势



资料来源：正能量电子网，天风证券研究所

DDIC 随着 2023 年价格基本稳定或略有下降，随着电视、游戏显示器和商用笔记本电脑等大型应用出货量回升带动 DDIC 需求增加。但由于持续的市场压力，DDIC 价格预计将继续呈下降趋势。中国工厂的面板生产日益集中，使长期主导 DDIC 市场的中国台湾供货商面临巨大压力。根据 Trendforce 数据，2022 年至 2023 年，中国大陆 TV DDIC 市场份额持续增加，从 19.6% 提升至 23.3%。

图 35: TV DDIC 地区市占率



资料来源：Trendforce，天风证券研究所

国际大厂 23Q4 收入同比减少，24Q1 展望营收或环比继续下行。国际模拟芯片大厂 TI、MPS 近期发布 23Q4 季报，各大厂商业绩在各自的下游应用领域表现均呈现下滑的态势，TI 的模拟领域营收为 31.20 亿美元，同比-12%，嵌入式处理领域实现营收 7.52 亿美元，同比-10%。

图 36: 国际模拟厂商 23Q4 业绩及下季度展望

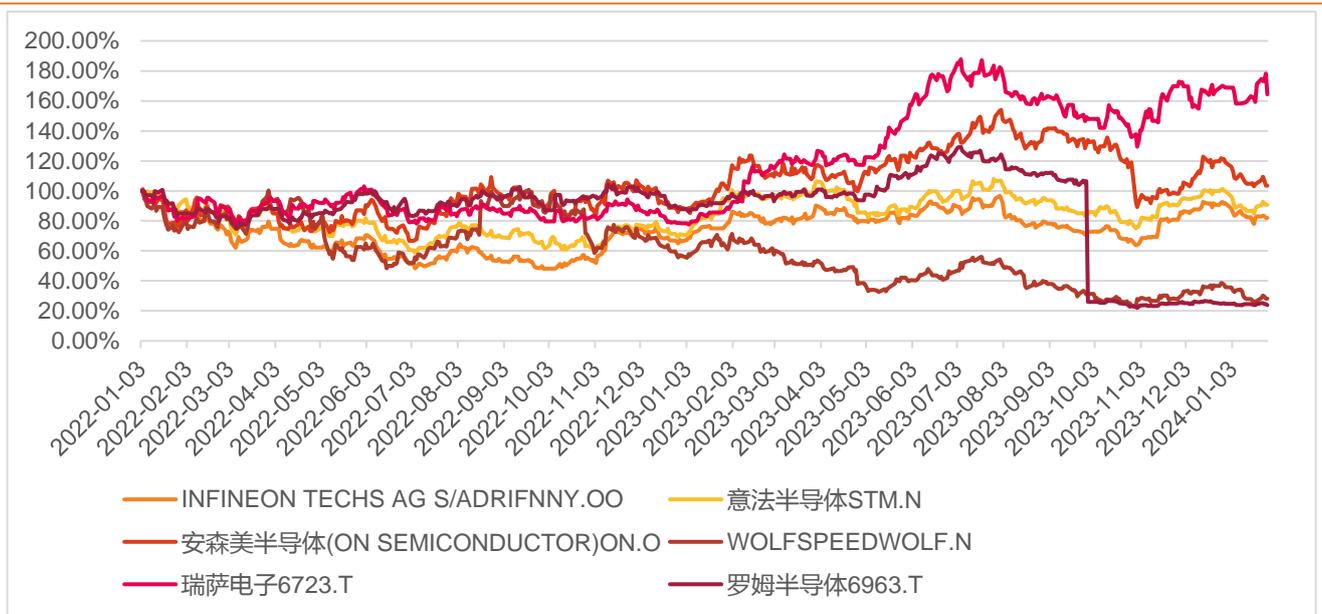
	23Q4						24Q1
	营收 (百万美元)	同比	环比	净利润 (百万美元)	同比	环比	23Q4指引
德州仪器TI	4077	-12.70%	-10.04%	1371	-30.12%	-19.78%	24Q1预计营收指引中值36亿美元,同比-17.79%/环比-13.25%。
亚德诺ADI	2716.5	-16.36%	-11.70%	498.4	-46.76%	-43.17%	24Q1预计营收指引中值25亿美元,同比-21.67%/环比-7.97%。
芯源MPS	454	-1.30%	-4.39%	96.9	-18.62%	-20.01%	24Q1预计营收中值4.47亿美元(4.37-4.57亿美元),同比-0.9%/环比-1.54%。

资料来源: 各公司公告, 天风证券研究所

5.1.4. 功率器件: 受地震影响部分日本功率半导体工厂停产, 部分品类行情或有波动

在过去的一个月(12.25-01.25)大部份功率器件厂商股价走低, 仅小部分厂商股价出现上涨。其中英飞凌/意法半导体/安森美/Wolfspeed 近一月股价分别下降 9.8%/9.0%/13.5%/23.0%。

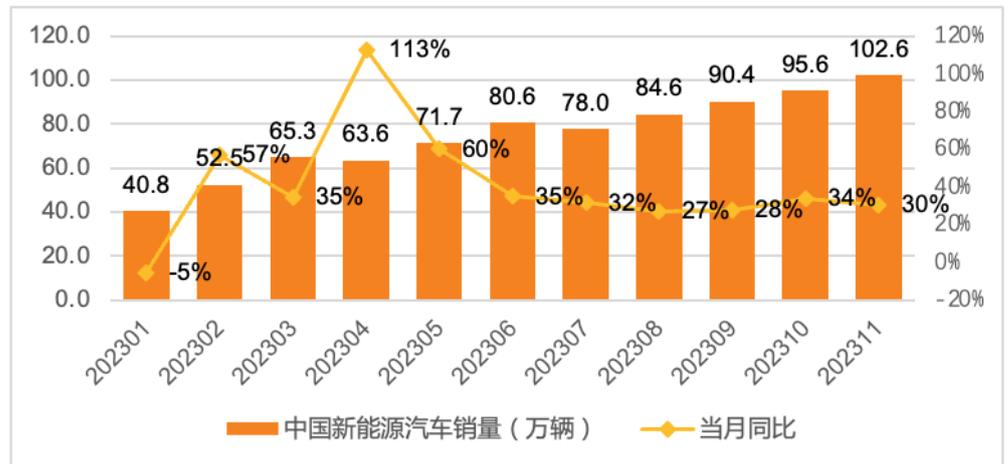
图 37: 英飞凌、意法半导体、安森美、Wolfspeed、瑞萨、罗姆股价相对涨跌幅



资料来源: Wind, 天风证券研究所 注: 以 2022/1/3 股价为基准

中国汽车工业协会发布汽车产销数据。1-11 月, 汽车产销分别完成 2711.1 万辆和 2693.8 万辆, 同比分别增长 10%和 10.8%。预计 2023 年我国汽车总销量为 3000 万辆左右, 其中乘用车销量为 2600 万辆左右, 商用车销量为 400 万辆左右, 新能源汽车销量为 940 万辆左右, 出口量为 480 万辆左右。中汽协同时预测, 2024 年我国汽车总销量为 3100 万辆左右, 其中乘用车销量为 2680 万辆左右, 商用车销量为 420 万辆左右, 新能源汽车销量为 1150 万辆左右, 出口量为 550 万辆左右。随着中国经济逐步恢复, 根据中汽协预计, 汽车市场需求将继续保持稳定增长, 未来中国汽车市场将进入 3000 万辆级别的新阶段。

图 38: 新能源汽车销量 (万辆) 与同比增速



资料来源: Wind, 天风证券研究所

根据 Trendforce 数据, 新能源汽车预计 2024 年成长率为 32%, 总销售量预计将达到 1,700 万台。比亚迪在插电式混合动力车市场中保持领先地位, 积极拓展品牌和产品组合。理想汽车凭借中国大型 SUV 需求的成长, 取得第二名 (10%), 实现了第一季销售超过 10 万辆的里程碑。

图 39: 23Q3BEV&PHEV 市占率

3Q23 BEV & PHEV Sales Ranking and Market Share

Rank	BEV	Market Share	PHEV	Market Share
1	Tesla	18.0%	BYD	35.2%
2	BYD	18.0%	Li Auto	10.0%
3	GAC Aion	5.8%	BMW	4.0%
4	Volkswagen	4.8%	Mercedes-Benz	3.9%
5	SAIC-GM-Wuling	4.6%	Deepal	3.6%
6	BMW	3.4%	Geely	3.4%
7	Hyundai	2.6%	Volovo cars	3.4%
8	Mercedes-Benz	2.5%	Toyota	3.1%
9	NIO	2.3%	Denza	3.0%
10	Kia	2.1%	Jeep	3.0%

Note: The data are based on brands, and some data are estimated values.
Source: TrendForce, Nov., 2023

资料来源: Trendforce, 天风证券研究所

国际功率大厂分部门营收受到下游需求分化明显, 国际大厂 Wolfspeed 预期 24Q1 营收环比微降, 部分中高端产品或标准组件逐步面临价格压力。

图 40: 全球主要功率器件厂商 23Q3 业绩情况及后续展望

	23Q4			24Q1
	营收	同比	环比	24Q1指引
英飞凌	37.02亿欧元	-6.30%	-10.77%	24Q1营收:36亿欧元,同比-12.62%/环比-2.76%。
ST	42.82亿美元	-3.21%	-3.50%	24Q1营收:36亿美元,同比-15.23%/环比-15.93%。
安森美	20.18亿美元	-4.06%	-7.46%	24Q1营收:18.5亿美元,同比-5.60%/环比-8.33%。
Wolfspeed	2.08亿美元	19.91%	5.57%	24Q1营收:2亿美元,同比-12.55%/环比-4.03%。

资料来源：各公司官网，天风证券研究所

5.1.5. 射频芯片：手机射频相关需求景气度回暖

海外龙头 Q4 普遍出现稼动率提升、毛利率和营收同比增长。1) 稳懋：2023 年第四季合并营收为新台币 48.68 亿元，优于原先的预期，较前一季成长 17%，较去年同期成长 38%。除了 Wi-Fi 客户主要备货期已过之外，其余的产品皆有二位数成长，同时得力于产能利用率自上一季的 50%上升到 60%，使得第四季营业毛利率自上一季的 22.1%上升到 29.4%，营业净利率也自上一季的 1.7%回升到 13.1%；2) Qorvo：23Q4 营收实现同比增长，24Q1 公司营收指引中值 9.25 亿美元(9- 9.5 亿美元),同比+46.20%/环比-13.87%。

图 41：全球主要功率器件厂商 23Q4 业绩情况及后续展望

	23Q4			24Q1
	营收	同比	环比	24Q1指引
Qorvo	10.74亿美元	44.48%	-2.69%	24Q1公司营收指引中值9.25亿美元(9- 9.5亿美元), 同比+46.20%/环比-13.87%
稳懋	48.68亿新台币	38.00%	17.00%	展望第一季，预期营收将较前一季下滑 low-teens 百分比，毛利率则预期为 mid-twenties 的水平。

资料来源：各公司官网，天风证券研究所

5.1.6. CIS：消费电子景气回暖及补库拉动业绩回升，三星 CIS 24 年有望开启涨价

受益于安卓手机景气回暖、终端厂商库存去化及新机拉货需求带动，CIS 公司 Q3 普遍迎来业绩复苏。例如思特威、韦尔股份、格科微等本土 CIS 厂商业绩看：思特威 Q3 营收 7.00 亿元，同比增长 8.58%，环比增长 13%；韦尔股份 Q3 营收 62.23 亿元，同比增长 44.35%，环比增长 37.58%；格科微 Q3 营收 12.93 亿元，同比增长 1.30%，环比增长 17.69%。三家均实现同环比双增，市场回暖已现端倪。同时，11 月底，三星向客户发出 CIS 涨价通知，明年一季度平均涨幅高达 25%，且个别产品涨幅最高上看 30%，成为本轮涨价幅度最大的芯片品类之一。

5.2. 代工：先进制程需求增长，台积电计划 2024 年底 3nm 产能提升至 80%

据 TrendForce 的数据，随着终端及 IC 客户库存陆续消化至较为健康的水位，及 2023 下半年 iPhone、Android 阵营推出新机等有利因素，带动晶圆厂第三季智能手机、笔电相关零部件急单涌现。受此影响，2023 年第三季度全球十大晶圆代工厂商的产值合计达 282.9 亿美元，环比增长 7.9%，回暖迹象明显。在增幅上，除了联电、华虹、力积电 3 家公司营收环比下滑外，其余 7 家营收均环比增长。其中，英特尔以 34.1%的数据在 Q3 营收中增长幅度最大；而华虹在当季营收下跌幅度达 9.3%，下降幅度最大。

表 9：23Q3 全球前十晶圆代工厂业绩及市场份额变化情况

排名	厂商名称	市场份额	3Q2023(百万美元)	2Q2023(百万美元)	环比增长
1	台积电(TSMC)	57.9%	17,249	15,656	10.2%
2	三星(Samsung)	12.4%	3,690	3,234	14.1%
3	格芯(GlobalFoundries)	6.2%	1,852	1,845	0.40%
4	联电(UMC)	6.0%	1,801	1,833	-1.7%
5	中芯国际(SMIC)	5.4%	1,620	1,560	3.8%
6	华虹集团 (Huahong Group)	2.60%	766	845	-9.3%
7	高塔半导体(Tower)	1.20%	358	357	0.3%
8	世界先进(VIS)	1.1%	333	321	3.8%
9	英特尔(IFS)	1.0%	311	232	34.1%
10	力积电(PSMC)	1.0%	305	330	-7.5%
	合计	95.0%	28,286	26,213	7.9%

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

展望未来，TrendForce 认为，受半导体下行周期影响 2023 年全球晶圆代工市场规模约 1,120 亿美元，同比下滑 10-15%。不过，其也认为当前芯片库存水平已回归常态，2024 年个人电脑、智能手机、服务器等关键终端产品均有望呈现正向增长，拉动半导体需求。因此，TrendForce 判断 2Q24 前后全球晶圆代工市场有可能确立上行趋势，并预计 2024 年全球晶圆代工市场规模有望迎来 5-10% 的增长。

表 10：全球晶圆代工厂对未来行情的看法

公司名称	对未来行情的主要看法
台积电	2024 年将是实现健康增长的一年，目前已经看到智能手机需求出现企稳回暖的初步信号，但在未来 2-3 年，智能手机增速仍低于企业平均水平；汽车业务方面，台积电指出，过去三年汽车需求非常强劲，不过从 2023 年下半年开始，汽车已经进入库存调整模式。
联电	联电共同总经理王石认为第四季度 PC 与手机需求会与第三季度相当，两大应用领域近期有急单出现，研判这是早期显示库存修正到一定程度的迹象，但有些应用的库存修正会延续到明年。另外，车用客户自 2022 年开始累积的高库存，有望在第四季度消化至一定水位。
力积电	力积电总经理谢再居称，目前有感受到供应链库存降到合理水位，并观察到包括手机用驱动 IC，以及监视系统采用的 CMOS 图像传感器（CIS）都有短单的需求，部分订单能见度甚至超过一个季度；另外，特殊存储产品单价格也展现回升态势，正向看待第四季度业绩表现。
世界先进	世界先进的展望则较为保守，该公司预期第四季度半导体供应链谨慎控管库存，虽然消费电子库存调整接近尾声；但车用与工业较晚修正库存，预期第四季度仍有明显修正，估计第四季度晶圆出货量季减 8%至 10%，产品平均销售单价（ASP）估季减 2%内，毛利率将持续下滑到 22%至 24%。
三星	三星晶圆代工事业也受益于先进制程、高中低阶 5G APSoC、5G modem 及成熟制程 28nm OLED DDI 等订单加持，推动其第三季度营收环比增长 14.1%至 36.9 亿美元。
格芯	格芯 Q1 和 Q2 产能利用率从 85%上升至 88%，由于格芯能承接来自美国航天、国防、医疗等特殊领域芯片代工，及车用相关订单与客户签订长约（LTA）而较为稳定，有效支撑格芯产能利用率。格芯 CEO ThomasCaulfield 在财报中表示，虽然全球经济及地缘政治仍充满不确定性，我们持续与客户密切合作，协助客户去化库存。
英特尔	受益于下半年笔记本电脑拉货季节性因素，加上拥有先进制程，英特尔 IFS 第三季营收环比增长 34.1%至约 3.1 亿美元，市场份额为 1%，自 Intel 财务拆分后排名首次进入全球前十
高塔半导体	高塔半导体受益于季节性因素，智能手机、车用/工控领域半导体需求相对稳定，第三季营收约 3.6 亿美元，大致与第二季持平，微幅增长 0.3%，市场份额为 1.2%
中芯国际	中芯国际联席 CEO 赵海军表示，在手机消费和工业控制领域，中国客户基本上达到了进出平衡的库存水平。但欧美客户依然处于历史高位。其次，汽车产品的相关库存开始偏高，正在引起客户对市场修正的警觉，下单开始迅速收紧。还有，三季度手机终端市场出现回暖迹象，整体行业认为明年整体消费电子会有回暖行情。
华虹公司	展望 2023 年第四季度，华虹半导体预计销售收入约在 4.5 亿美元至 5.0 亿美元之间，预计毛利率约在 2%至 5% 之间。产能方面，截至第三季度末，华虹半导体折合 8 英寸晶圆月产能增加至 35.8 万片，总体产能利用率为 86.8%。

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

1 月，终端客户订单前景依然不明朗，整体产能利用率仍面临下行压力。

图 42：主要晶圆代工厂动态

厂商	1月动态	2月价格趋势
台积电	扩大CoWoS封装产能；计划2024年底3nm产能提升至80%	稳定
三星	晶圆代工报价调降5%-15%	下降
联电	新加坡22nm新厂年中完工	下降
中芯国际	或降价抢单	下降
格芯	Q1降幅高达15%-20%	稳定
世界先进	目前市场能见度约2-3个月	下降
力积电	2024年AI、电动车将现跳跃式成长	下降
华虹	无锡七厂一期扩产完毕	下降

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.3. 封测：先进封装需求供不应求，行业复苏趋势明显

1月，行业产能利用率低迷，订单有所好转。根据芯八哥预计，日月光2023年平均产能利用率约为60-65%，24年1月产能利用率为60-65%，预计2月订单上升。长电科技1月产能利用率约70-80%，预计2月订单维持稳定。通富微电AI相关订单上升，1月产能利用率达75-85%，预计2月订单维持稳定。华天科技需求有复苏迹象，1月产能利用率也达到85%。

图 43：主要封测厂商动态

厂商	1月动态	2月订单预测
日月光	2023年平均产能利用率约为60~65%	上升
长电科技	23Q4订单恢复2023年同期水平	稳定
通富微电	AI相关订单上升	稳定
华天科技	需求有复苏迹象	下降
气派科技	拓展第三代半导体和功率器件封测品类	下降
中小封测厂	订单波动	下降

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

AI需求全面提升，带动先进封装需求提升，台积电启动CoWoS大扩产计划。今年一季度以来，市场对AI服务器的需求不断增长，加上Nvidia的强劲财报，造成台积电的CoWoS封装成为热门话题。据悉，Nvidia、博通、谷歌、亚马逊、NEC、AMD、赛灵思、Habana等公司已广泛采用CoWoS技术。台积电董事长刘德音在今年股东大会上表示，最近因为AI需求增加，有很多订单来到台积电，且都需要先进封装，这个需求远大于现在的产能，迫使公司要急遽增加先进封装产能。

Chiplet/先进封装技术有望带动封测产业价值量提升，先进封装未来市场空间广阔。据Yole分析，先进封装(AP)收入预计将从2022年的443亿美元增长到2028年的786亿美元，年复合增长率为10%。在封装领域，2.5D、3D Chiplet中高速互联封装连接及TSV等提升封装价值量，我们预测有望较传统封装提升双倍以上价值量，带来较高产业弹性。

业绩端来看，根据各公司第三季度报告，可以显著发现各公司营收均有环比改善，归母净

利润环比改善或跌幅收窄，整体呈缓慢复苏态势。

图 44：主要封测企业 23Q3 业绩（营收、归母净利润）环比显著改善（%）（环比数据）

		22Q1	22Q2	22Q3	22Q4	23Q1	23Q2	23Q3
长电科技	营收	-5.21%	-8.39%	23.19%	-2.18%	-34.77%	7.73%	30.79%
	归母净利润	2.14%	-20.79%	33.28%	-14.30%	-85.88%	250.91%	23.83%
通富微电	营收	-2.32%	12.51%	13.56%	6.21%	-24.01%	13.44%	13.92%
	归母净利润	-35.04%	21.82%	-44.78%	-77.48%	-80.00%	-3940.00%	164.58%
华天科技	营收	-6.87%	6.82%	-9.55%	-4.37%	-19.43%	27.29%	4.56%
	归母净利润	-46.65%	48.31%	-38.11%	-73.68%	-312.00%	-259.43%	-88.17%

资料来源：Wind，天风证券研究所

5.4. 设备材料零部件：1 月，可统计设备中标数量 27 台，招标数量 27 台

1 月，硅晶圆需求低迷，设备需求相对稳定，关注设备出口管控变化。

图 45：半导体设备及硅晶圆头部企业情况

类型	企业	1月订单	1月库存	2月订单预测
设备	ASML	上升	低	上升
	AMAT	稳定	低	稳定
	泛林	稳定	低	稳定
	TEL	稳定	低	稳定
	科磊	稳定	低	稳定
	北方华创	上升	低	上升
硅晶圆	中微公司	上升	低	上升
	信越化学	下降	一般	下降
	Sumco (胜高)	下降	一般	下降
	环球晶圆	下降	较高	下降
	台胜科技	下降	较高	下降
	合晶科技	下降	较高	下降
	沪硅产业	上升	一般	上升

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

5.4.1. 设备及零部件中标情况：1 月可统计设备中标数量同比出现下滑

2024 年 1 月，可统计设备中标数量 27 台，同比-46%，其中薄膜沉积设备中标 2 台，同比-50%；辅助设备 1 台，同比持平；检测设备 2 台，同比-93.10%；刻蚀设备 7 台，同比+75%。

图 46：2024 年 1 月部分国内企业可统计中标情况（台）

	薄膜沉积设备	辅助设备	检测设备	刻蚀设备	其他	总计
北方华创		2			7	15
精测半导体				1		1
上海精测				1		1
上海正帆科技股份有限公司			1			1
总计	2	1	2	7		15

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

2024 年 1 月，北方华创可统计中标设备 24 台，同比+100%。其中，薄膜沉积设备 2 台，同比+100%；刻蚀设备 7 台，同比+600%；其他设备 15 台。

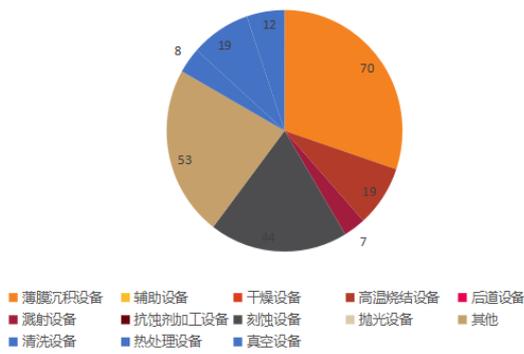
图 47：2020-2024.1 北方华创可统计中标情况（台）

年份	薄膜沉积设备	辅助设备	干燥设备	高温烧结设备	光刻设备	刻蚀设备	清洗设备	其他	真空设备	总计
2020年	20	31	3	10	30	7	4	70	21	133
1月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
3月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
4月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
5月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
6月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
7月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
8月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
9月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
10月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
11月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
12月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
2021年	48	90	3	4	18	910	3	2	11	1048
1月	3	7	1	1	2	372	1	1	3	393
2月	3	1	1	1	2	139	1	1	2	150
3月	3	1	1	1	2	10	1	1	2	20
4月	2	4	1	1	1	1	1	1	1	12
5月	9	1	1	1	1	1	1	1	1	15
6月	1	42	1	1	1	30	1	1	1	78
7月	1	4	1	1	1	9	1	1	1	19
8月	7	8	1	1	4	279	1	1	1	308
9月	3	1	1	1	1	1	1	1	1	10
10月	7	5	1	1	1	4	1	1	1	22
11月	9	2	1	1	1	1	1	1	1	17
12月	5	4	1	1	3	75	1	1	1	99
2022年	35	110	8	3	24	804	5	1	12	1007
1月	1	2	1	1	1	57	1	1	1	68
2月	4	1	1	1	1	128	1	1	1	138
3月	2	1	1	1	2	3	1	1	1	10
4月	1	23	1	1	2	1	1	1	1	29
5月	12	2	1	1	1	14	1	1	1	29
6月	1	13	1	1	1	5	1	1	1	22
7月	1	2	1	1	12	130	1	1	1	146
8月	2	57	1	1	1	25	1	1	1	87
9月	1	1	1	1	1	16	1	1	1	21
10月	1	57	1	1	1	90	1	1	1	156
11月	10	8	1	1	1	107	1	1	1	129
12月	10	2	1	1	1	228	1	1	1	248
2023年	82	20	19	18	4024	6	50	7	1098	5371
1月	4	1	1	1	28	1	4	1	1	41
2月	4	1	1	1	33	1	11	1	1	53
3月	26	1	1	1	11	1	3	1	1	44
4月	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7
5月	3	12	1	1	62	1	1	1	1	81
6月	3	3	1	1	4	1	1	1	1	13
7月	3	3	1	1	699	2	1	1	1	710
8月	27	3	1	1	2380	1	9	1	1	2433
9月	2	1	1	1	588	1	1	1	1	600
10月	2	1	1	1	7	1	2	1	1	14
11月	5	1	1	1	7	1	3	1	1	19
12月	9	1	1	1	214	1	9	1	1	236
2024年	2	1	0	0	0	2	0	15	0	18
1月	2	1	0	0	0	2	0	15	0	18

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 48：2023 年北方华创各主要设备类型中标分布情况（台）

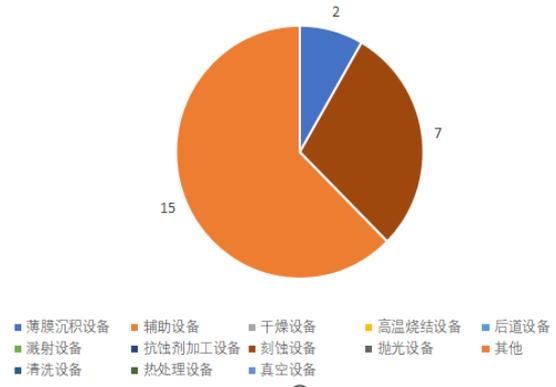
北方华创2023年各主要设备类型中标分布情况



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 49：2024 年 1 月北方华创各主要设备类型中标分布情况（台）

北方华创2024年1月各主要设备类型中标分布情况



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

2024 年 1 月，国内半导体零部件可统计中标共 14 项，同比-54.84%。主要为电气类 10 项，为北方华创、英杰电气中标，机械类 1 项，为菲利华中标，气液。真空系统类 3 项，为汉钟精机、北京北方华创真空技术有限公司中标。

图 50：2011-2024.1 国内半导体设备零部件可统计中标情况（台）

	电气类	光学类	机电一体类	机械类	气液/真空系统类	仪器仪表类	总计
北方华创	54					2	56
2021年						1	1
2022年	1					1	2
2023年	47						47
2024年	6						6
北方华创旗下七星流量计							1
2023年						1	1
北广科技	6						6
2013年	1						1
2016年	1						1
2020年	1						1
2021年	3						3
北京北方华创真空技术有限公司	3					3	6
2023年	3					2	5
2024年						1	1
菲利华（湖北）			1	19		1	21
2018年				1			1
2020年			1	2		1	4
2021年				6			6
2022年				6			6
2023年				3			3
2024年				1			1
菲利华（上海）				4			4
2023年				3			3
2022年				1			1
富创精密				1		2	3
2021年						1	1
2022年						1	1
汉钟精机	3			42		6	51
2019年						1	1
2021年						1	1
2022年	1			5		1	7
2023年	2			37		1	40
2024年						2	2
华卓精科	1			6	1		8
2022年				3			3
2023年	1			3	1		5
英杰电气	116	1		3		1	121
2011年	2						2
2013年	1						1
2014年	1						1
2015年	7						7
2016年	3						3
2017年	3						3
2018年	7						7
2019年	9					1	10
2020年	10	1					11
2021年	18						18
2022年	20						20
2023年	31			3			34
2024年	4						4
中国科学院微电子研究所	3						3
2019年	1						1
2020年	1						1
2023年	1						1
总计	186	2	48	28		15	1 280

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

2024年1月，国外半导体零部件可统计中标共21项，同比-40.00%。主要为光学类8项，机械类2项，电气类1项，气液/真空系统类10项。分公司来看，Newport和蔡司可统计中标零部件最多，为5项，Pfeiffer 2项，Elliott Ebara Singapore 4项，EBARA 1项，Inficon 1项，VAT 2项，MKS 1项。

图 51：2011-2024.1 国外半导体设备零部件可统计中标情况（台）

	电气类	光学类	机电一体类	机械类	气液/真空系统类	总计
Advanced Energy	14					14
2015年	1					1
2017年	2					2
2018年	3					3
2019年	1					1
2020年	3					3
2021年	3					3
2022年	1					1
Brooks			2		21	23
2014年			1			1
2017年			1		1	2
2018年					1	1
2019年					5	5
2021年					4	4
2022年					7	7
2023年					3	3
Cymer		2				2
2017年		1				1
2018年		1				1
EBARA				1	33	34
2014年					4	4
2018年					3	3
2019年					4	4
2020年					2	2
2021年				1	7	8
2022年					5	5
2023年					7	7
2024年					1	1
Elliott Ebara Singapore					21	21
2019年					1	1
2022年					4	4
2023年					12	12
2024年					4	4
Ferrotec			2			2
2021年			1			1
2022年			1			1
Inficon		1		1	44	46
2018年					1	1
2019年					1	1
2021年				1		1
2022年					5	5
2023年		1			36	37
2024年					1	1
MKS	15	4			39	58
2012年					1	1
2015年					3	3
2017年	2				7	9
2018年					5	5
2019年	2				7	9
2020年		1			3	4
2021年	5				8	13
2022年	3					3
2023年	2	3			5	10
2024年	1					1
MKS、Inficon					1	1
2018年					1	1
MKS、VAT					1	1
2020年					1	1
Newport	1	83		21	1	106
2022年	1	8			1	10
2023年		72		19		91
2024年		3		2		5
Pfeiffer					141	141
2015年					5	5
2016年					5	5
2017年					4	4
2018年					8	8
2019年					7	7
2020年					21	21
2021年					19	19
2022年					26	26
2023年					44	44
2024年					2	2
Pfeiffer、VAT					2	2
2020年					2	2
VAT					25	25
2011年					1	1
2017年					1	1
2018年					3	3
2019年					2	2
2020年					1	1
2021年					1	1
2022年					5	5
2023年					9	9
2024年					2	2
蔡司	1	151			2	154
2017年		2				2
2019年	1	3				4
2020年		6				6
2021年		4				4
2022年		37			2	39
2023年		94				94
2024年		5				5
总计	31	241	4	23	331	630

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

5.4.2. 设备招标情况：1月可统计设备招标数量 27 台，同比-46%

2024 年 1 月，可统计设备中标数量 27 台，同比-46%，其中薄膜沉积设备中标 2 台，同比-50%；辅助设备 1 台，同比持平；检测设备 2 台，同比-93.10%；刻蚀设备 7 台，同比+75%。

图 52：2024 年 1 月部分国内企业可统计招标情况（台）

	辅助设备	检测设备	其他	清洗设备	热处理设备
上海积塔半导体有限公司	16	104	161	98	590
总计	4	116	1	81	1

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

2024 年 1 月，华虹华力可统计招标设备共 0 台。

2020-2024 年 1 月，华虹华力可统计招标设备共 3589 台，包括 246 台薄膜沉积设备、395 台辅助设备、56 台光刻设备、69 台后道设备、304 台检测设备、152 台刻蚀设备、388 台热处理设备等。

图 53：2020-2024.1 华虹华力可统计招标情况（台）

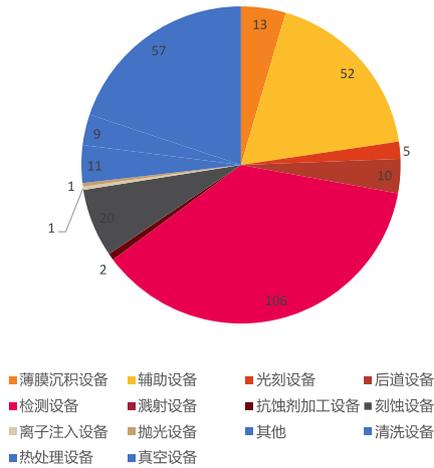
	薄膜沉积设备	辅助设备	光刻设备	后道设备	检测设备	刻蚀设备	抗蚀剂加工设备	离子注入设备	抛光设备	其他	清洗设备	热处理设备	真空设备	总计
2020年	122	90	20	5	147	6	56	20	20	1321	76	52	193	2128
1月					3									8
2月					43					1270	10			1357
3月	20	52	10		36			19	13	11	19	25	19	371
4月	56	32	3							3	30		46	172
5月	4											2		12
6月	7		1		16				2					38
7月	5				10				1	2		3	5	32
8月	4			3	1									12
9月	7		1		11				2				7	36
10月		2			3									6
11月	14		1	1	22			8		1		18		66
12月	5				2			4				5	3	21
2021年	101	240	10	26	16	2	5	62	12	17	173	38	248	950
1月	1	217			1	2					1		126	348
2月		2												3
3月											1			6
4月					3								4	10
5月				2	1								3	6
6月			1	6	1				1			4	1	14
7月	5	21	1	4	6					1	170	3		211
8月	1		4	2										8
9月	1													3
10月	1													5
11月			1											2
12月	92		7	10				5	53	11	15	28	113	334
2022年	13	52	5	10	106	2	20	1	1	11	9	57		287
1月	3	2	3	75								4		88
2月	1	6						1						8
3月	4	2	1	3	6					1	1	3		31
4月	1				1						1		34	38
5月	2	38											8	48
6月														0
7月	2							2						4
8月	1				2						1			6
9月	1				4						8	2	5	20
10月					1									1
11月			1		1					1				5
12月	1	3	1	4	16								7	38
2023年	10	13	21	28	35		21	14		7	17	16	31	224
1月	5	1			1			3			1	1	4	16
2月	1	3									13			28
3月		6												6
4月											1			1
5月								6						6
6月														0
7月	4	3	21	27	31		21	2		6	1	20		136
8月												1	6	9
9月				1	1						2			4
10月					1							13		14
11月								1		1			1	3
12月					1									3
2024年														0

资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

图 54：2022 年华虹华力各主要设备类型中标分布情况（台）

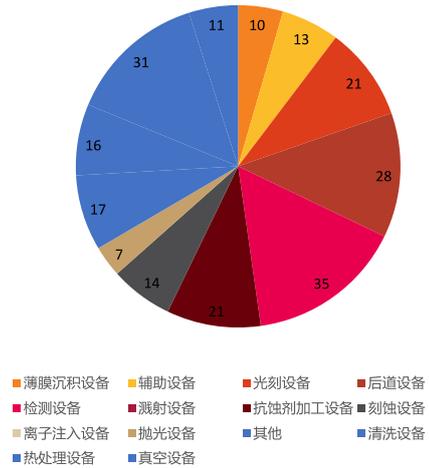
图 55：2023 年华虹华力各主要设备类型中标分布情况（台）

华虹华力2022年主要设备类型招标分布



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

华虹华力2023年主要设备类型招标分布



资料来源：千里马招标网，天风证券研究所 注：统计数据或不完善，具体以各公司官方披露为准

5.5. 分销商：整体分销市场需求逐步回升，2024 年行业复苏可期

1 月，分销商需求持续回升，库存得到优化，业绩有改善。

图 56：主要元器件分销商最新动态

厂商	1月动态
大联大	2023营收6721.8亿新台币，年减13.4%
文晔科技	23Q4营收1897亿新台币，季增13.41%
中电港	客户涵盖国内电子信息行业头部企业
香农芯创	获无锡国资投资入局
商络电子	新能源客户包括阳光电源、西门子及禾迈等
雅创电子	2023年底以来订单有改善迹象
好上好	库存持续改善

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

6. 终端应用：看好消费电子复苏，关注元宇宙发展走势

6.1. 消费电子：1 月 AI 成 PC 市场新增长点，关注苹果 MR 新品对供应链影响

基于 Q3 季度的良好市场反馈，业内机构普遍看好 2024 年的行情。其中，在手机领域，根据 IDC 预测，2023 年全球智能手机出货量将同比下降 1.1%至 11.9 亿部，2024 年全球智能手机出货量将同比增长 4.2%至 12.4 亿部；在折叠手机领域，根据 Counterpoint，2023 年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长 52%达 2270 万部，预计在 2024 年进入折叠屏手机的快速普及期，2025 年将达 5500 万部；在 PC 领域，根据 IDC 的数据，23Q3 全球 PC 出货量为 6820 万台，环比增长 11%，出货量已经连续两个季度环比增长。据其预测，PC 销量在 2023 年急剧下降 14%后，在 2024 年将增长 4%；而在笔电领域，据 TrendForce 的数据，2023 年三季度，全球笔记本出货量已经连续两个季度实现环比增长。据其预测，2024 年全球笔记本市场整体出货规模将达 1.72 亿台，年增 3.2%。

表 11：业内机构普遍看好 2024 年消费电子行业的发展

主要品类	预测情况
手机	根据 IDC 预测，2023 年全球智能手机出货量将同比下降 1.1%至 11.9 亿部，2024

年全球智能手机出货量将同比增长 4.2%至 12.4 亿部。

折叠手机 根据 Counterpoint，2023 年全球折叠屏智能手机出货量预计将同比增长 52% 达 2270 万部，预计将在 2024 年开始进入折叠屏手机的快速普及期，2025 年 将达 5500 万部。

PC 根据 IDC 的数据，23Q3 全球 PC 出货量为 6820 万台，环比增长 11%，同比降 幅收窄至 8%，PC 出货量连续两个季度环比增长，市场出现好转迹象。IDC 预计 PC 销量在 2023 年急剧下降 14%后，在 2024 年将增长 4%

笔电 据 TrendForce 的数据，2023 年三季度，全球笔记本出货量实现连续两个季 度的环比增长，同比降幅持续收窄。据其预测，2024 年全球笔记本市场整体 出货规模将达 1.72 亿台，年增 3.2%。

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

1 月，整体市场需求持续恢复，AI 成 PC 市场新增长点，关注苹果 MR 新品对供应链影响。

表 12：消费电子厂商最新动态

类别	企业	1 月动态
智能手机	苹果	2023 年首次超过三星登顶智能手机年度销冠
	三星	2023 年手机出货量 2.266 亿部,市场份额为 19.4%
	华为	折叠手机大幅追单
	OPPO	2023 年手机出货量 1 亿部
	传音	2023 年手机出货量进入全球前五
	荣耀	2023 年中国市场智能手机出货量第二
PC	联想	AI PC 上市加速
	宏基	看好 AI 相关产品增长
	戴尔	2023 年 PC 销量暴跌 20%
VR/AR	Meta	对 AI 部门进行大规模改组
	苹果	Vision Pro 头显美国发售
	HTC	VR 业务发展缓慢

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

6.2. 新能源汽车：强者恒强，行业进入加速洗牌期

1 月，新能源汽车行业“强者恒强”，行业进入加速洗牌期。

表 13：新能源汽车厂商最新动态

厂商	1 月动态
比亚迪	2023 年汽车销量达 302.44 万辆；拟投入 1000 亿元发力自动驾驶
特斯拉	2023 年汽车销量达 181 万辆
本田	与通用合作电车拟 3 月北美上市
大众	在华主要燃油车均向新能源转型
宝马	在华纯电产品增至 7 款
奔驰	2024 年推出 15 款新车
丰田	预计纯电动汽车市占率最多 30%
福特	宣布关停全部电车生产
Stellantis	意大利工厂裁员约 2250 人
广汽埃安	拟赴港上市
吉利	2023 年新能源车同比增长 51%
奇瑞	计划进军英国市场
理想	开启了新一轮产品降价

长城	2023 年新能源车销售 26.2 万辆，同比增长 98.74%
华为	与东风岚图达成战略合作

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

6.3. 工控：工控行业订单低迷，国产品牌市占率提升

1 月，工控行业订单低迷，国产品牌市占率提升。

表 14：工控厂商最新动态

厂商	1 月动态
施耐德	部分 Ethernet 产品价格上调 5%-20%
西门子	Q1 财季业绩将好于市场预期
汇川技术	国产产品市占率不断提升
英威腾	订单稳定，产能充足
禾川科技	国内工控市场竞争日趋激烈
埃斯顿	开发汽车等增量市场
新时达	整体库存较高

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

6.4. 光伏：光伏行业市场供大于求，库存去化仍在持续

1 月，光伏行业市场供大于求，库存去化仍在持续。

表 15：光伏厂商最新动态

厂商	1 月动态
阳光电源	2023 年净利润或超百亿
天合光能	2023 年光伏组件出货量约 70GW；光伏行业面临供大于求问题
锦浪科技	预计 2024 年海外逆变器业务占比 60%
固德威	较为依赖美国等海外市场
德业股份	欧洲逆变器库存较少，但行业库存仍处于去化过程中
昱能科技	欧洲库存相对较高

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

6.5. 储能：行业库存问题仍存在，终端需求维持乐观预期

1 月，行业库存问题仍存在，终端需求维持乐观预期。

表 16：储能厂商最新动态

厂商	1 月动态
阳光电源	2023 年储能业务海外收入占比超过 80%
科士达	欧洲市场竞争日趋激烈
上能电气	公司库存改善明显
科陆电子	子公司与斯特拉签署电池储能系统采购订单
德业股份	2024 年储能逆变器营收有望超 40 亿元
锦浪科技	Q1 欧洲市场库存问题仍存在
特斯拉	2023 年储能装机量同比增长 125%
科华数据	积极布局美国等海外储能市场

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

6.6. 服务器：AI 服务器及上游核心芯片需求维持稳定，看好 2024 年市场增长

1 月，AI 服务器及上游核心芯片需求维持稳定，看好 2024 年市场增长。

表 17：服务器厂商最新动态

企业	1月动态
英伟达	H20 特供芯片或 2024Q2 量产
AMD	MI300 系列 24 年或出货 40-60 万颗
浪潮	AI 服务器订单稳定增长
纬创	服务器营收占比已经超过三成
广达	乐观看待未来 AI 服务器需求
工业富联	2024-2026 年公司 AI 服务器或维持 20%-30%的高增长

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

6.7. 通信：通信相关需求低迷，预计今年市场需求进一步下滑

1月，通信相关需求低迷，预计今年市场需求进一步下滑。

表 18：通信厂商最新动态

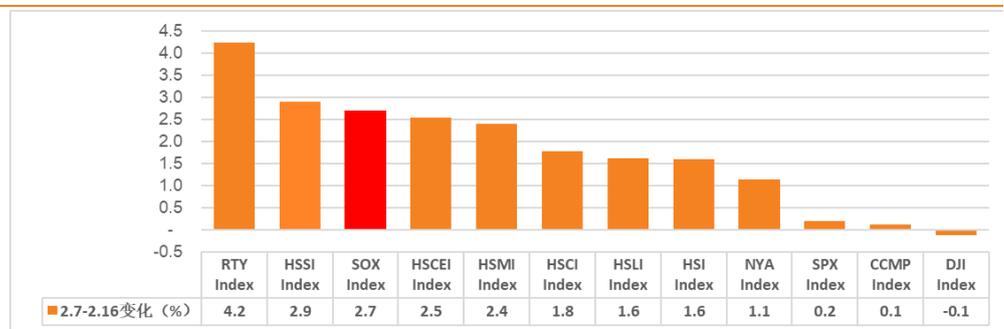
企业	1月动态
爱立信	预计 2024 年 5G 设备需求将下滑；或进一步裁员
中兴通讯	积极布局 5G-A 相关设备
诺基亚	23Q4 可比营业利润同比下降 27%
烽火通信	积极进行 6G 相关产品和技术的预研和布局

资料来源：芯八哥公众号，天风证券研究所

7. 本周海外半导体行情回顾

上周（02/07-02/16）海外各重点指数表现较好，绝大部分实现增长，费城半导体指数增幅较大。其中 RTY Index 涨幅最大为 4.2%，DJI Index 跌幅最大为 0.1%。费城半导体指数表现优于其余大部分指数。

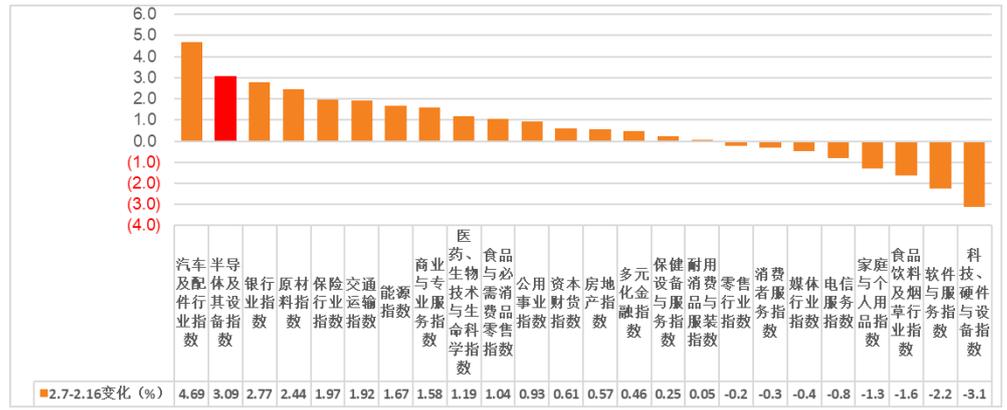
图 57：上周海外重点指数对比（%）



资料来源：Bloomberg，天风证券研究所

上周（02/07-02/16）标普 500 行业指数有涨有跌，汽车及配件行业指数领涨。其中汽车及配件行业指数涨幅最大为 4.7%，科技、硬件与设备指数跌幅最大为 3.1%。半导体及其设备指数表现优于大部分标普 500 行业指数。

图 58：上周标普 500 行业指数对比（%）



资料来源: Bloomberg, 天风证券研究所

8. 本周 (02/19-02/23) 半导体行情回顾

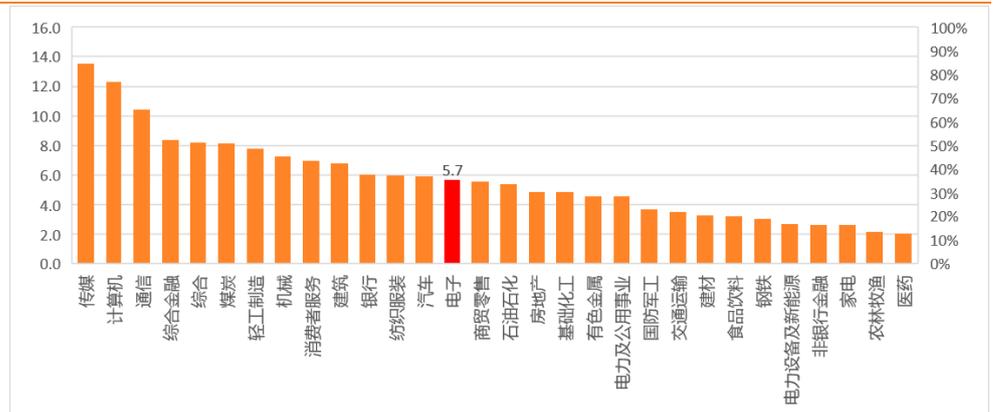
上周 (02/19-02/23) 半导体行情优于大部分主要指数。上周创业板指数上涨 1.81%，上证综指上涨 4.85%，深证综指上涨 2.82%，中小板指上涨 2.60%，万得全 A 上涨 5.18%，申万半导体行业指数上涨 5.09%，半导体行业指数行情优于除万得全 A 以外其他主要指数。

表 19: 上周半导体行情与主要指数对比

	本周涨跌幅%	半导体行业相对涨跌幅 (%)
创业板指数	1.81	3.28
上证综合指数	4.85	0.24
深证综合指数	2.82	2.27
中小板指数	2.60	2.49
万得全 A	5.18	-0.08
半导体 (申万)	5.09	-

资料来源: Wind, 天风证券研究所

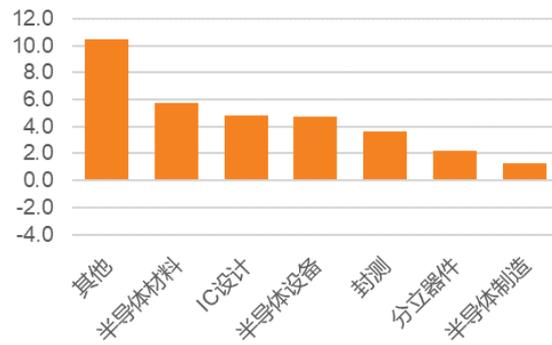
图 59: 上周 A 股各行业行情对比 (%)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

半导体各细分板块涨幅明显，其他板块领涨，半导体制造涨幅最低。半导体细分板块中，IC 设计板块上周上涨 4.9%，半导体材料板块上周上涨 5.8%，分立器件板块上周上涨 2.2%，半导体设备板块上周上涨 4.8%，封测板块上周上涨 3.6%，半导体制造板块上周上涨 1.3%。

图 60: 上周子版块涨跌幅 (%)



资料来源: Wind, 天风证券研究所

上周半导体板块涨幅前 10 的个股为: 文一科技, 佰维存储, 亿通科技, 源杰科技, 北京君正, 恒烁股份, 力芯微, 寒武纪-U, 德明利, 晶升股份。

上周半导体板块跌幅前 10 的个股为: 格科微, 恒玄科技, 安路科技, 翱捷科技-U, 上海合晶, 圣邦股份, 晶晨股份, 华海清科, 拓荆科技, 唯捷创芯。

表 20: 上周涨跌幅前十半导体个股

本周涨幅前 10	涨跌幅%	本周跌幅前 10	涨跌幅%
文一科技	41.19	格科微	-8.80
佰维存储	37.48	恒玄科技	-8.48
亿通科技	36.75	安路科技	-5.61
源杰科技	33.92	翱捷科技-U	-4.19
北京君正	32.14	上海合晶	-3.34
恒烁股份	29.29	圣邦股份	-3.31
力芯微	26.13	晶晨股份	-3.04
寒武纪-U	22.90	华海清科	-2.18
德明利	20.88	拓荆科技	-2.13
晶升股份	20.81	唯捷创芯	-2.07

资料来源: Wind, 天风证券研究所

9. 本周 (02/19-02/23) 重点公司公告

【东芯股份 688110.SH】

基于战略规划考虑与业务发展需要, 公司拟与自然人荣苏江合资设立子公司上海亿芯通感技术有限公司, 从事 Wi-Fi7 无线通信芯片的研发、设计与销售。注册资本人民币 3,000 万元。

【万业企业 600641.SH】

公司于 2024 年 2 月 8 日接到控股股东浦科投资的知会函, 获悉其所持有本公司的部分股份被质押, 质押起始日为 2024 年 2 月 7 日, 质权人为西藏信托有限公司, 占公司总股本比例 1.61%。

【万业企业 600641.SH】

为维护公司价值及股东权益, 公司本次拟回购部分公司股份, 不低于人民币 2.5 亿元(含)且不超过人民币 5.0 亿元(含), 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准, 拟回购价格: 不超过人民币 19.90 元/股(含)。

【上海新阳 300236.SZ】

公司以自有资金参与由长鑫芯聚股权投资(安徽)有限公司持有90%股权的子公司安徽启航鑫睿私募基金管理有限公司发起设立产业投资基金。该产业基金名称为合肥启航恒鑫投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“启航恒鑫基金”),募集规模人民币10.625亿元。公司认缴人民币10,000万元作为有限合伙人。

【顾中科技 688352.SH】

业绩预告:2023年度,公司实现营业收入162,934.00万元,较上年度增长23.71%;公司实现归属于母公司所有者的净利润37,017.03万元,较上年度增长22.10%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润32,514.55万元,较上年度增长19.93%。

【奕瑞科技 688301.SH】

2024年2月6日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份10,928股,占公司总股本的0.0107%,回购最高价格261.61元/股,回购最低价格255.01元/股,使用资金总额为人民币2,820,765.78元。

【敏芯股份 688286.SH】

2024年2月20日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份54,166股,占公司总股本55,887,596股的比例为0.0969%,回购成交的最高价为36.30元/股,最低价为35.09元/股,支付的资金总额为人民币1,923,779.91元。

【至纯科技 603690.SH】

截至2024年2月20日,公司股份回购方案期限已届满。本次回购方案公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份144.6320万股,占公司总股本的比例为0.3739%,购买的最高价为28.00元/股、最低价为26.502元/股,已支付的总金额为3,899.85万元(不含印花税、佣金等交易费用)。

【聚辰股份 688123.SH】

公司拟使用不低于人民币5,000万元(含)、不超过人民币10,000万元(含)的超募资金回购股份,所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。

【华峰测控 688200.SH】

业绩预告:2023年度,公司实现营业收入69,086.19万元,较上年同期下降35.47%;实现归属于母公司所有者的净利润24,947.69万元,较上年同期下降52.60%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润24,932.13万元,较上年同期降低50.68%。

【深科技 000021.SZ】

公司下属控股子公司成都长城开发科技股份有限公司于2024年1月10日收到了北交所出具的审核问询函。深科技成都于2024年2月21日披露2023年年度审阅报告,并将于近日向北交所报送第一轮问询回复。截止目前,公司持有深科技成都69.72%的股权。

【太极实业 600667.SH】

公司子公司十一科技与NextSolarEnergyGroup签订了《乌兹别克斯坦共和国纳曼干地区波普斯基区500兆瓦(一期)光伏电站项目合同》。十一科技的工程承包范围包括施工区域的施工辅助工程、光伏组件、箱逆变一体机等设备的安装工程、建筑工程及其他与工程建设相关的工作。

【太极实业 600667.SH】

公司子公司十一科技于近日收到招标人重庆芯联微电子有限公司发来的《重庆市建设工程中标通知书》,确认十一科技与中建一局组成的联合体为重庆12英寸集成电路特色工艺线项目(一期)EPC总承包的中标人,中标价人民币2,497,000,000元。

【大港股份 002077.SZ】

公司全资子公司江苏科力半导体有限公司作为有限合伙人出资 2,500 万元认购上海厚雪私募投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙份额，占合伙企业认缴出资总额的 4.17%。

【甬矽电子 688362.SH】

以集中竞价交易方式回购公司股份 本次回购的资金总额不低于人民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），若按本次回购价格上限 31.53 元/股（含）测算，公司本次回购的股份数量约为 1,268,634 股至 1,902,949 股，约占公司总股本的 0.3112% 至 0.4668%。

【佰维存储 688525.SH】

限制性股票激励计划：本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票合计 3000 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 43,032.9136 万股的 6.97%。其中，首次授予 2400 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 43,032.9136 万股的 5.58%，占本激励计划拟授出权益总数的 80%。预留授予权益 600 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 43,032.9136 万股的 1.39%，预留部分占拟授予权益总额的 20%。

【银河微电 688689.SH】

以集中竞价交易方式回购公司股份：用于员工持股计划或股权激励，拟回购股份 150.00-250.00 万股，占公司总股本比例 1.16%-1.94%，拟回购资金总额 3,000.00-5,000.00 万元，本次回购的价格不超过人民币 20.00 元/股。

【正帆科技 688596.SH】

业绩快报：公司 2023 年度实现营业收入 383,523.59 万元，同比增长 41.80%；归母净利润 40,174.09 万元，同比增长 55.31%；扣非净利润 33,694.73 万元，同比增长 57.28%。公司 2023 年度新签订单 66 亿元，同比增长 60%；截至 2023 年 12 月 31 日，在手合同 61 亿元，同比增长 76%。

【利扬芯片 688135.SH】

业绩快报：2023 年公司实现营业收入为 50,308.45 万元，较上年同期增长 11.19%，创下自成立以来历史新高，基本实现公司在 2020 年业绩说明会时制定的“以 2020 年营业收入为基础，三年翻一番，五年达 10 个亿”第一阶段的营收目标；归母净利润 2,165.14 万元，较上年同期下降 32.37%；扣非净利润 1,140.37 万元，较上年同期下降 46.91%。

【气派科技 688216.SH】

业绩快报：2023 年度，公司实现营业收入 55,426.35 万元，较上年同期增长 2.57%；营业利润-15,933.31 万元，较上年同期减少 8,010.51 万元；利润总额-16,144.64 万元，较上年同期减少 8,239.56 万元；归母净利润-13,214.35 万元，较上年同期减少 7,358.08 万元；扣非净利润-15,518.76 万元，较上年同期减少 8,088.52 万元。

【汇成股份 688403.SH】

业绩快报：2023 年度，公司实现营业总收入 123,829.30 万元，较上年同期增长 31.78%；实现归属于母公司所有者的净利润 19,578.68 万元，较上年同期增长 10.47%；归母净利润 16,813.42 万元，较上年同期增长 33.25%。

【泰凌微 688591.SH】

业绩快报：2023 年度，公司实现营业收入 63,609.19 万元，同比增长 4.40%；营业利润 5,041.41 万元，同比增长 1.85%；利润总额 5,049.24 万元，同比增长 2.37%；归属于母公司所有者的净利润 5,005.77 万元，同比增长 0.55%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2,294.89 万元，同比下降 34.06%。

【甬矽电子 688362.SH】

业绩快报：2023 年度，公司实现营业收入 2,392,476,006.55 元，较上年同期增长 9.90%；

实现营业利润-169,008,554.08 元,较上年同期减少 208.42%;实现归属于母公司所有者的净利润-97,001,221.72 元,较上年同期减少 170.22%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-163,355,379.98 元,较上年同期减少 376.69%。

【伟测科技 688372.SH】

业绩快报:2023 年度,公司实现营业收入 73,652.48 万元,较上年度增长 0.48%。公司实现归属于母公司所有者的净利润 11,701.55 万元,较上年度下降 51.91%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,797.31 万元,较上年度下降 56.34%。

【翱捷科技 688220.SH】

业绩快报:2023 年度,公司实现营业收入 259,991.61 万元,较上年同期增加 21.48%;实现归属于母公司所有者的净利润为-51,094.84 万元,亏损额较上年同期增加 25,944.23 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-66,165.11 万元,亏损额较上年同期增加 28,844.17 万元。

10. 本周 (02/19-02/23) 半导体重点新闻

ADI 扩大与台积电的合作,提高供应链产能和韧性。近日,ADI 宣布已与全球领先的专用半导体代工厂台积电达成协议,由台积电在日本熊本县的控股制造子公司——日本先进半导体制造公司(“JASM”)提供长期芯片产能供应。基于 ADI 与台积电 30 多年的合作关系,此次达成的协议为 ADI 扩大先进制程节点的产能提供了更多选择,以更好地满足 ADI 业务中关键平台的需求,包括无线 BMS (wBMS)和千兆多媒体串行链路(GMSL™)应用。双方的共同努力进一步巩固了 ADI 强韧的混合制造网络,有助于降低外部因素影响、快速扩大产能和规模,以满足客户需求。

Cirrus Logic、英特尔和微软联手推出全新参考设计,打造“超酷、安静和高性能”的 PC。 Cirrus Logic 近日宣布与英特尔和微软在全新的 PC 参考设计上进行合作。该设计将采用 Cirrus Logic 的高性能音频和电源技术以及英特尔即将推出的代码为 Lunar Lake 的客户端处理器。除了为笔记本电脑创造更丰富、更沉浸式的音频体验外,此次合作还将减少发热,延长电池寿命,并实现更小、更轻薄的设计。

SK 海力士预计 3 月量产 HBM3E,供货英伟达。Moneytoday 2 月 21 日消息,SK 海力士 1 月中旬结束 HBM3E 开发,顺利完成英伟达历时半年性能评估,3 月将投产 HBM3E 高频宽记忆体,供应英伟达首批产品,领先同业。这批 HBM3E 将用于英伟达下代 Blackwell 系列 AI 芯片旗舰产品 B100,英伟达计划第二季末或第三季初推出产品。当前,英伟达已在 AI GPU 市场有超过 90%以上市占率,存储市场 SK 海力士则有全球 HBM 一半以上市占率,更 100% 垄断 128GB DDR5 大容量 DRAM 市场。

美国切断中芯国际南部工厂供应链。2 月 22 日消息,美国政府宣布禁止中芯国际南部工厂(中芯南方)从美国进口产品。美国商务部去年末向数十家美国供应商发函,暂停向中芯国际南部工厂出售产品。其中大部分公司此前已经停止向该工厂供货,受影响最大的是美国一家位于马萨诸塞州名叫英特格的半导体生产设备公司。英特格专注生产处理晶圆的过滤器、气体、化学品以及制造芯片的基本材料。尽管路透社并未发现该公司的出口存在违法违规的情况,但该公司价值上千万美元的出口还是被叫停。中芯国际是英特格最大的客户之一,其订单占该公司 35 亿美元营收的 16%。消息一出,英特格的股价在周三立刻下跌 1.9%。

英飞凌出售两座封测厂,日月光接手。半导体封测厂日月光投控 2 月 23 日宣布,收购晶片大厂英飞凌位于菲律宾和韩国的两座后段封测厂,扩大在车用和工业自动化应用的电源晶片模组封测与导线架封装,投资金额逾新台币 21 亿元,最快今年第 2 季底完成交易。此次收购英飞凌在菲律宾和韩国的两座封测厂,代表日月光投控承诺与英飞凌双方延续长期策略伙伴关系的决心。英飞凌韩国封测据点有 300 名员工,菲律宾封测厂有超过 900 名员工,日月光投控表示,当地两厂员工继续留用。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心 B 座 11 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100088	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com